

2024年05月20日



华鑫证券  
CHINA FORTUNE SECURITIES

# GPT-4o 横空出世，人机语音低延时交互时代开启

—电子行业周报

推荐(维持)

投资要点

分析师：毛正 S1050521120001

maozheng@cfsc.com.cn

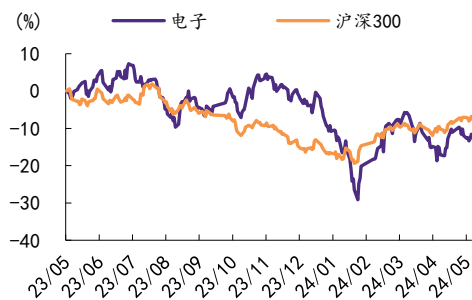
分析师：吕卓阳 S1050523060001

lvzy@cfsc.com.cn

## 行业相对表现

表现	1M	3M	12M
电子(申万)	4.3	10.8	-9.9
沪深300	3.0	9.3	-7.0

## 市场表现



资料来源：Wind，华鑫证券研究

## 相关研究

- 1、《电子行业周报：苹果接近与 OpenAI 达成协议，22 家中国量子机构被列入实体清单》2024-05-12
- 2、《电子行业周报：OpenAI 有望于近期发布 ChatGPT 搜索引擎，AI 应用前景可期》2024-05-06
- 3、《电子行业周报：海力士季报超预期，三星与 AMD 签署 HBM3E 供货协议》2024-04-29

## 上周回顾

5月13日-5月17日当周，申万一级行业大部分处于上涨状态。其中电子行业上涨1.34%，位列第9位。估值前三的行业为综合、计算机、国防军工，电子行业市盈率为53.27，位列第4位。

电子行业细分板块比较，5月13日-5月17日当周，电子行业细分板块处于上涨态势。估值方面，数字芯片设计、半导体材料、模拟芯片设计估值水平位列前三，半导体设备、LED估值排名本周第四、五位。

## OpenAI 全新模型 GPT-4o 横空出世，响应时间接近真人

5月14日凌晨，美国人工智能研究公司 OpenAI 在线上举办了“春季更新”活动，OpenAI 在活动中发布了新旗舰模型“GPT-4o”，GPT-4o 可以接受文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出。相比于 GPT-3.5 和 GPT-4，GPT-4o 可以以接近人类反应时间的 232 毫秒的时间内对输入的音频作出响应，平均耗时为 320 毫秒，GPT-4o 在音频 ASR 性能方面显著提高了所有语言的语音识别性能，尤其是资源较少的语言，并且能够直接观察音调、多个说话者以及背景噪音，甚至可以表达情感输出笑声以及歌声。GPT-4o 在英语文本和代码上的性能与 GPT-4 Turbo 的性能相近，在非英语文本上的性能显著提高。GPT-4 真正意义上做到了原生多模态，在原有模型推理出文本内容之外，GPT-4 能够实时推理出音频和视觉，GPT-4o 在英语文本和代码上的性能也与 GPT-4 Turbo 处于同一水平线，在非英语文本上的性能有着显著提高，同时 API 速度快，速率限制高出 5 倍，成本则降低了 50%。如此低延时相应的背后，是基于算力基础设施的加速部署，得益于网络优化、推理引擎、并发处理等技巧，因此算力硬件链条值得持续关注。在如此高效的语音交互模式下，下游消费电子产品手机、智能音响、耳机等产品将进一步被赋能，我们可以想象，当 OpenAI 与苹果进一步深入合作之后，“AI iPhone”的时代会不会提前到来，凭借苹果产品的整体生态，全球 10 亿苹果用户的调用量将对模型的商业化带来多大的变化？这一切都值得期待。密切关注：国光电器、漫步者、嘉和智能、恒

轩科技、工业富联、沪电股份、胜宏科技、生益电子。

## ■ 台积电特殊工艺扩产，前瞻备战 HBM4

台积电计划到 2027 年将其特种技术产能扩大 50%，台积电在欧洲技术研讨会上透露，预计不仅需要转换现有产能以满足特殊工艺的需求，甚至还需要为此目的建造新的（绿地）晶圆厂空间。下一个专用节点：N4e，一个 4 纳米级超低功耗生产节点是这一需求的主要驱动力。台积电近年来的扩张战略追求几个目标。其中之一是在台湾以外建立新的晶圆厂；另一个是普遍扩大产能，以满足未来对所有类型工艺技术的需求。台积电在 2024 年欧洲技术研讨会提供了有关将为 HBM4 制造的基础芯片的一些新细节，该芯片将使用逻辑工艺构建。对于第一波 HBM4，台积电准备使用两种制造工艺：N12FFC+ 和 N5。N12FFC+ 具有成本效益的基础芯片可以达到 HBM 的性能，而 N5 基础芯片可以在 HBM4 速度下以低得多的功耗提供更多逻辑，台积电采用 N12FFC+ 制造工艺（12nm FinFet Compact Plus，正式属于 12nm 级技术，但其根源于台积电经过充分验证的 16nm FinFET 生产节点）制造的基础芯片将用于在硅片上安装 HBM4 内存堆栈片上系统 (SoC) 旁边的中介层。台积电正针对 HBM4 优化 CoWoS-L 和 CoWoS-R。作为一种更先进的替代方案，内存制造商还可以选择采用台积电的 N5 工艺来生产 HBM4 基础芯片。N5 构建的基础芯片将封装更多的逻辑，消耗更少的功耗，并提供更高的性能。台积电和 SK 海力士在 HBM4 基础芯片上进行合作，台积电设计与技术平台高级总监表示：“台积电正在与主要 HBM 内存合作伙伴（美光、三星、SK 海力士）合作，在先进节点上实现 HBM4 全堆栈集成。”建议关注：通富微电、赛腾股份、金智达、芯源微、雅克科技。

## ■ 风险提示

半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。

### 重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2024-05-18		EPS			PE			投资评级
		股价	2023	2024E	2025E	2023	2024E	2025E		
002045.SZ	国光电器	12.38	0.6349	0.5598	0.6798	43.6852	22.12	18.21	未评级	
002156.SZ	通富微电	20.82	0.1117	0.59	0.74	69.8386	35.29	28.14	增持	
002351.SZ	漫步者	13.45	0.4719	0.6085	0.7266	63.7208	22.10	18.51	未评级	
002409.SZ	雅克科技	59.46	1.2176	2.1025	2.8225	50.5919	28.28	21.07	未评级	
002463.SZ	沪电股份	32.41	0.7925	1.1768	1.4657	31.0038	27.54	22.11	未评级	
300476.SZ	胜宏科技	30.00	0.7782	1.345	1.7278	20.1311	22.30	17.36	未评级	
300793.SZ	佳禾智能	13.51	0.392	0.518	0.6121	42.3223	26.08	22.07	买入	
601138.SH	工业富联	25.70	1.0591	1.2722	1.5198	14.9639	20.20	16.91	未评级	
603283.SH	赛腾股份	65.51	3.4286	4.096	4.7679	47.3465	15.99	13.74	未评级	
688037.SH	芯源微	89.25	1.8176	2.91	4.43	92.0414	30.67	20.15	买入	

688183.SH	生益电子	13.59	-0.03	0.68	0.4303	30.2254	19.99	31.58	买入
688608.SH	恒玄科技	127.20	1.0299	2.51	4.19	151.2649	50.68	30.36	买入
688627.SH	精智达	53.77	1.2305	1.8	2.49	126.6756	29.87	21.59	增持

资料来源: Wind, 华鑫证券研究(注:“未评级”盈利预测取自万得一致预期)

## 正文目录

1、 股票组合及其变化.....	6
1.1、 本周重点推荐及推荐组 .....	6
1.2、 海外龙头一览 .....	8
2、 周度行情分析及展望.....	10
2.1、 周涨幅排行 .....	10
2.2、 行业重点公司估值水平和盈利预测 .....	13
3、 行业高频数据.....	16
3.1、 台湾电子行业指数跟踪 .....	16
3.2、 电子行业主要产品指数跟踪 .....	19
4、 近期新股.....	23
4.1、 灿芯股份（688691.SH）：一站式芯片定制服务供应商 .....	23
4.2、 中瑞股份（301587.SZ）：深耕电池精密安全结构件的高科技企业.....	26
5、 行业动态跟踪.....	28
5.1、 半导体 .....	28
5.2、 消费电子 .....	32
5.3、 汽车电子 .....	34
6、 行业重点公司公告.....	36
7、 风险提示.....	40

## 图表目录

图表 1：重点关注公司及盈利预测 .....	7
图表 2：海外龙头估值水平及周涨幅 .....	8
图表 3：费城半导体指数近两周走势 .....	9
图表 4：费城半导体指数近两年走势 .....	9
图表 5：5月13日-5月17日行业周涨跌幅比较（%） .....	10
图表 6：5月17日行业市盈率（TTM）比较.....	10
图表 7：5月13日-5月17日电子细分板块周涨跌幅比较（%） .....	11
图表 8：5月17日电子细分板块市盈率（TTM）比较.....	11
图表 9：重点公司周涨幅前十股票 .....	12
图表 10：行业重点关注公司估值水平及盈利预测 .....	13
图表 11：台湾半导体行业指数近两周走势 .....	16
图表 12：台湾半导体行业指数近两年走势 .....	16
图表 13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势 .....	16
图表 14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势 .....	16

图表 15: 台湾电子零组件行业指数近两周走势 .....	17
图表 16: 台湾电子零组件行业指数近两年走势 .....	17
图表 17: 台湾光电行业指数近两周走势 .....	17
图表 18: 台湾光电行业指数近两年走势 .....	17
图表 19: 中国台湾 IC 各板块产值当季同比变化 (%) .....	18
图表 20: NAND 价格 (单位: 美元) .....	19
图表 21: DRAM 价格 (单位: 美元) .....	19
图表 22: 全球半导体销售额 (单位: 十亿美元) .....	19
图表 23: 全球分地区半导体销售额 (单位: 十亿美元) .....	19
图表 24: 面板价格 (单位: 美元/片) .....	20
图表 25: 国内手机月度出货量 (单位: 万部, %) .....	20
图表 26: 全球手机季度出货量 (单位: 百万部, %) .....	20
图表 27: 无线耳机月度出口量 (单位: 个, %) .....	21
图表 28: 无线耳机累计出口量 (单位: 个, %) .....	21
图表 29: 中国智能手表月度产量 (单位: 万个, %) .....	21
图表 30: 中国智能手表累计产量 (单位: 万个, %) .....	21
图表 31: 全球 PC 季度出货量 (单位: 百万台, %) .....	22
图表 32: 中国台机/服务器月度出货量 (单位: 万台) .....	22
图表 33: 中国新能源车月度销售量 (单位: 万辆, %) .....	22
图表 34: 中国新能源车累计销售量 (单位: 万辆, %) .....	22
图表 35: 欧莱新材主要产品概况 .....	23
图表 36: 欧莱新材营业收入 (亿元) .....	25
图表 37: 欧莱新材归母净利润 (亿元) .....	25
图表 38: 灿芯股份产品应用情况 .....	26
图表 39: 灿芯股份营业收入 (亿元) .....	27
图表 40: 灿芯股份归母净利润 (亿元) .....	27
图表 41: 本周重点公司公告 .....	36

# 1、股票组合及其变化

## 1.1、本周重点推荐及推荐组

### (1) OpenAI 全新模型 GPT-4o 横空出世，响应时间接近真人

5月14日凌晨，美国人工智能研究公司 OpenAI 在线上举办了“春季更新”活动，OpenAI 在活动中发布了新旗舰模型“GPT-4o”，GPT-4o 可以接受文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出。相比于 GPT-3.5 和 GPT-4，GPT-4o 可以以接近人类反应时间的 232 毫秒的时间内对输入的音频作出响应，平均耗时为 320 毫秒，GPT-4o 在音频 ASR 性能方面显著提高了所有语言的语音识别性能，尤其是资源较少的语言，并且能够直接观察音调、多个说话者以及背景噪音，甚至可以表达情感输出笑声以及歌声。GPT-4o 在英语文本和代码上的性能与 GPT-4 Turbo 的性能相近，在非英语文本上的性能显著提高。GPT-4 真正意义上做到了原生多模态，在原有模型推理出文本内容之外，GPT-4 能够实时推理出音频和视觉，GPT-4o 在英语文本和代码上的性能也与 GPT-4 Turbo 处于同一水平线，在非英语文本上的性能有着显著提高，同时 API 速度快，速率限制高出 5 倍，成本则降低了 50%。如此低延时相应的背后，是基于算力基础设施的加速部署，得益于网络优化、推理引擎、并发处理等技巧，因此算力硬件链条值得持续关注。在如此高效的语音交互模式下，下游消费电子产品手机、智能音响、耳机等产品将进一步被赋能，我们可以想象，当 OpenAI 与苹果进一步深入合作之后，“AI iPhone”的时代会不会提前到来，凭借苹果产品的整体生态，全球 10 亿苹果用户的调用量将对模型的商业化带来多大的变化？这一切都值得期待。密切关注：国光电器、漫步者、嘉和智能、恒轩科技、工业富联、沪电股份、胜宏科技、生益电子。

### (2) 台积电特殊工艺扩产，前瞻备战 HBM4

台积电计划到 2027 年将其特种技术产能扩大 50%，台积电在欧洲技术研讨会上透露，预计不仅需要转换现有产能以满足特殊工艺的需求，甚至还需要为此目的建造新的（绿地）晶圆厂空间。下一个专用节点：N4e，一个 4 纳米级超低功耗生产节点是这一需求的主要驱动力。台积电近年来的扩张战略追求几个目标。其中之一是在台湾以外建立新的晶圆厂；另一个是普遍扩大产能，以满足未来对所有类型工艺技术的需求。台积电在 2024 年欧洲技术研讨会提供了有关将为 HBM4 制造的基础芯片的一些新细节，该芯片将使用逻辑工艺构建。对于第一波 HBM4，台积电准备使用两种制造工艺：N12FFC+ 和 N5。N12FFC+ 具有成本效益的基础芯片可以达到 HBM 的性能，而 N5 基础芯片可以在 HBM4 速度下以低得多的功耗提供更多逻辑，台积电采用 N12FFC+ 制造工艺（12nm FinFet Compact Plus，正式属于 12nm 级技术，但其根源于台积电经过充分验证的 16nm FinFET 生产节点）制造的基础芯片将用于在硅片上安装 HBM4 内存堆栈片上系统(SoC)旁边的中介层。台积电正针对 HBM4 优化 CoWoS-L 和 CoWoS-R。作为一种更先进的替代方案，内存制造商还可以选择采用台积电的 N5 工艺来生产 HBM4 基础芯片。N5 构建的基础芯片将封装更多的逻辑，消耗更少的功耗，并提供更高的性能。台积电和 SK 海力士在 HBM4 基础芯片上进行合作，台积电设计与技术平台高级总监表示：“台积电正在与主要 HBM 内存合作伙伴（美光、三星、SK 海力士）合作，在先进节点上实现 HBM4 全堆栈集成。”建议关注：通富微电、赛腾股份、金智达、芯源微、雅克科技。

图表 1：重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2024-05-18 股价	EPS			PE			投资评级
			2023	2024E	2025E	2023	2024E	2025E	
002045.SZ	国光电器	12.38	0.6349	0.5598	0.6798	43.6852	22.12	18.21	未评级
002156.SZ	通富微电	20.82	0.1117	0.59	0.74	69.8386	35.29	28.14	增持
002351.SZ	漫步者	13.45	0.4719	0.6085	0.7266	63.7208	22.10	18.51	未评级
002409.SZ	雅克科技	59.46	1.2176	2.1025	2.8225	50.5919	28.28	21.07	未评级
002463.SZ	沪电股份	32.41	0.7925	1.1768	1.4657	31.0038	27.54	22.11	未评级
300476.SZ	胜宏科技	30.00	0.7782	1.345	1.7278	20.1311	22.30	17.36	未评级
300793.SZ	佳禾智能	13.51	0.392	0.518	0.6121	42.3223	26.08	22.07	买入
601138.SH	工业富联	25.70	1.0591	1.2722	1.5198	14.9639	20.20	16.91	未评级
603283.SH	赛腾股份	65.51	3.4286	4.096	4.7679	47.3465	15.99	13.74	未评级
688037.SH	芯源微	89.25	1.8176	2.91	4.43	92.0414	30.67	20.15	买入
688183.SH	生益电子	13.59	-0.03	0.68	0.4303	30.2254	19.99	31.58	买入
688608.SH	恒玄科技	127.20	1.0299	2.51	4.19	151.2649	50.68	30.36	买入
688627.SH	精智达	53.77	1.2305	1.8	2.49	126.6756	29.87	21.59	增持

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

## 1.2、海外龙头一览

5月13日-5月17日当周，海外龙头大部分处于上涨态势。超威半导体领涨，涨幅为8.26%；英飞凌领跌，跌幅为2.62%。

图表 2：海外龙头估值水平及周涨幅

	证券代码	证券简称	国家/地区	市值(亿元) 2024-5-17	PE(LYR)	PB(MRQ)	周涨跌幅(%)
处理器	INTC.O	英特尔(INTEL)	美国	1,355.00	80.2252	1.2786	6.6332
	QCOM.O	高通(QUALCOMM)	美国	2,163.48	29.9153	8.8417	6.4697
	AMD.O	超威半导体(AMD)	美国	2,658.35	311.2824	4.7303	8.2609
	NVDA.O	英伟达(NVIDIA)	美国	22,784.30	76.5601	53.0139	2.8939
存储	MU.O	美光科技(MICRON TECHNOLOGY)	美国	1,387.42	-23.7857	3.1626	3.3405
模拟	TXN.O	德州仪器(TEXAS INSTRUMENTS)	美国	1,775.62	27.4143	10.4553	4.2609
	ADI.O	亚德诺(ANALOG)	美国	1,061.64	32.0294	2.9865	3.3255
	AVGO.O	博通(BROADCOM)	美国	6,466.07	45.9173	9.1999	4.6886
	NXPI.O	恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	684.5166	24.4732	7.753	2.2886
射频	SWKS.O	思佳讯(SKYWORKS)	美国	150.2101	15.2839	2.3621	1.5401
	QRVO.O	QORVO	美国	95.0326	-135.1393	2.6722	0.7575
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	375.1133	8.9079	2.1969	2.7894
	ON.O	安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)	美国	314.8007	14.4159	3.875	3.8462
光学	IFX.DF	英飞凌科技	德国	483.2561	15.405	2.8093	-2.6184
半导体设备	3008.TW	大立光	中国台湾	3,103.14	17.3337	1.8749	4.2601
	AMAT.O	应用材料(APPLIED MATERIAL)	美国	1,762.17	25.7026	9.6828	1.1205
	LRCX.O	拉姆研究(LAM RESEARCH)	美国	1,192.45	26.4347	14.8646	-0.366
	KLAC.O	科天半导体(KLA)	美国	1,006.68	29.7193	32.5271	4.3063
	ASML.O	阿斯麦	荷兰	3,649.83	41.9598	24.4551	-0.5719
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	2,269.33	11.4775	3.4151	0.7767
光刻胶	4185.T	JSR	日本	9,034.14	57.2361	2.459	-0.0461
	2330.TW	台积电	中国台湾	249,156.06	25.4224	5.9557	4.1147
晶圆代工	GFS.O	格芯(GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	299.6793	29.3803	2.6636	5.598
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	600.0398	-753.2794	1.7672	1.0714
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	230.8257	22.2699	2.3722	0.000
分销	ARW.N	艾睿电子(ARROW ELECTRONICS)	美国	70.0132	7.7491	1.2285	4.0339
	AVT.O	安富利(AVNET)	美国	48.1998	6.253	0.9661	3.0531

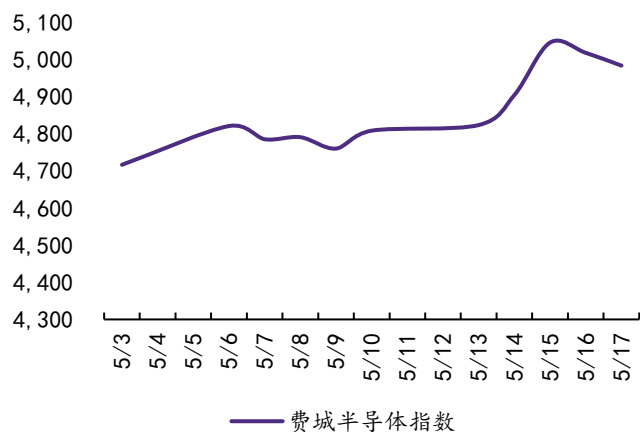
资料来源：wind，华鑫证券研究，截至2024年5月17日收盘价



从更宏观角度，我们可以用费城半导体指数来观察海外半导体行业整体情况。该指数涵盖了 17 家 IC 设计商、6 家半导体设备商、1 家半导体制造商和 6 家 IDM 商，且大部分以美国厂商为主，能较好代表海外半导体产业情况。

从数据来看，5 月 13 日-5 月 17 日当周，费城半导体指数呈现先升后降的态势，近两周整体处于上涨态势。更长时间维度上来看，指数在进入 2022 年下行通道后，2023 年 1-6 月，复苏迹象明显，处于震荡上行行情；7 月以来处于下行行情；10 月底开始持续上涨。

图表 3：费城半导体指数近两周走势



资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 4：费城半导体指数近两年走势



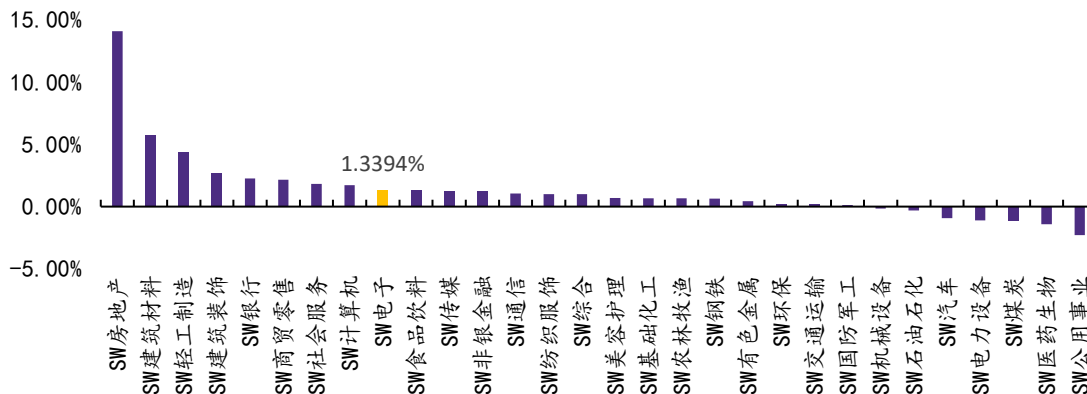
资料来源：wind，华鑫证券研究

## 2、周度行情分析及展望

### 2.1、周涨幅排行

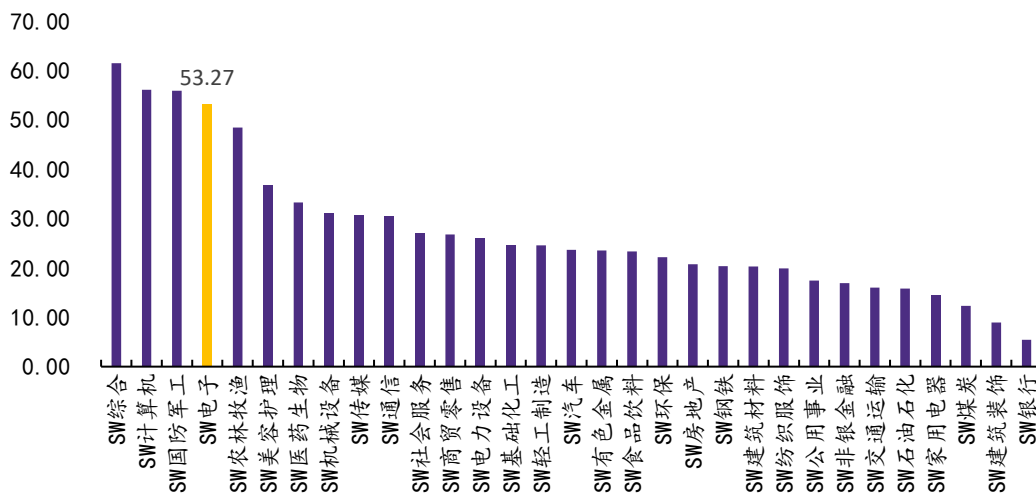
跨行业比较，5月13日-5月17日当周，申万一级行业大部分处于上涨状态。其中电子行业上涨1.34%，位列第9位。估值前三的行业为综合、计算机、国防军工，电子行业市盈率为53.27，位列第4位。

图表5：5月13日-5月17日行业周涨跌幅比较（%）



资料来源：wind，华鑫证券研究  
注：按申万行业一级分类

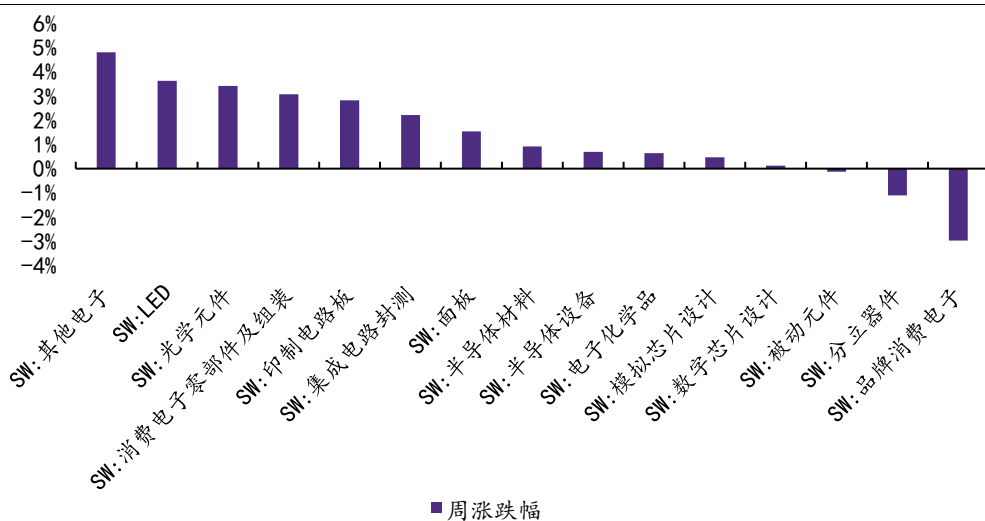
图表6：5月17日行业市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究  
注：按申万行业一级分类

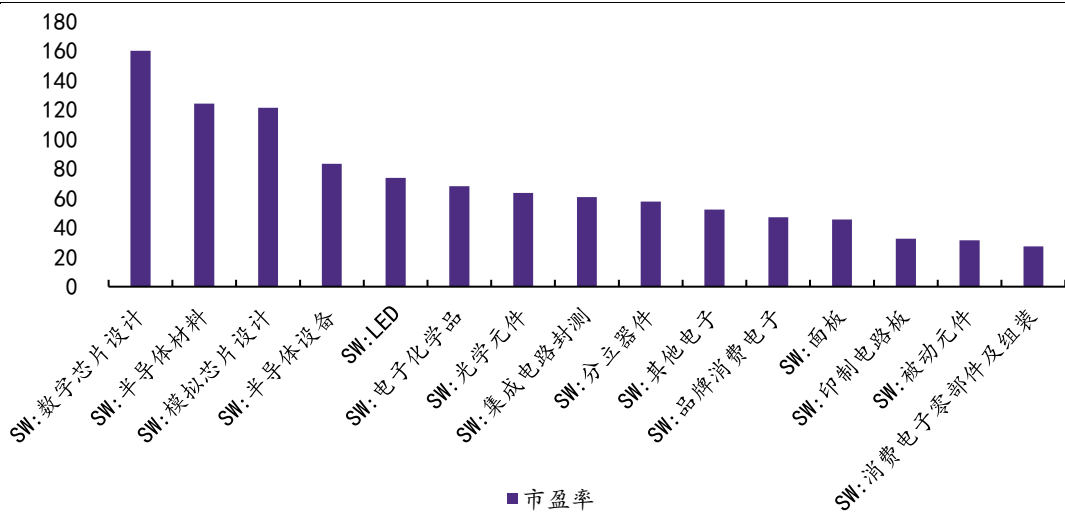
电子行业细分板块比较，5月13日-5月17日当周，电子行业细分板块处于上涨态势。估值方面，数字芯片设计、半导体材料、模拟芯片设计估值水平位列前三，半导体设备、LED估值排名本周第四、五位。

图表 7: 5月13日-5月17日电子细分板块周涨跌幅比较 (%)



资料来源: wind, 华鑫证券研究  
注: 按申万行业三级分类

图表 8: 5月17日电子细分板块市盈率 (TTM) 比较



资料来源: wind, 华鑫证券研究  
注: 按申万行业三级分类

5月13日-5月17日当周，重点关注公司周涨幅前十：消费电子零部件及组装、PCB各占两席，激光设备、LED设备、光学元件、Chiplet、封测各占一席。德龙激光（激光设备）、方邦股份（PCB）、和林微纳（消费电子零部件及组装）包揽前三，周涨幅分别为15.53%、13.96%、13.81%。

图表 9：重点公司周涨幅前十股票

分类	证券代码	证券简称	市值 (亿元) 2024-05-17	ROE (%)	EPS			PE			PB	周涨跌幅 (%)	投资评级
					2023	2024E	2025E	2023	2024E	2025E			
激光设备	688170.SH	德龙激光	28.91	4.50	0.38	0.55	0.93	103	51	30	2.24	15.53	增持
PCB	688020.SH	方邦股份	26.74	1.46	-0.85	0.64	1.25	-57	51	27	1.82	13.96	买入
消费电子零部件及组装	688661.SH	和林微纳	44.95	0.00	-0.23	1.92	3.49	-197	26	14	3.69	13.81	买入
LED设备	688383.SH	新益昌	71.29	13.02	0.59	4.20	5.13	177	17	14	5.05	7.19	买入
光学元件	688502.SH	茂莱光学	51.16	4.78	0.88	1.92	2.66	245	51	37	4.40	7.13	增持
Chiplet	300493.SZ	润欣科技	39.76	9.20	0.07	0.31	0.43	121	25	18	3.71	4.93	买入
消费电子零部件及组装	002241.SZ	歌尔股份	577.15	6.45	0.32	1.70	0.83	66	10	20	1.88	4.26	买入
PCB	603920.SH	世运电路	124.30	13.61	0.92	1.13	1.31	20	21	18	1.81	4.02	买入
封测	002156.SZ	通富微电	315.86	6.39	0.11	0.59	0.74	207	35	28	2.25	3.94	增持
消费电子零部件及组装	300793.SZ	佳禾智能	45.72	6.50	0.39	1.00	0.61	55	13	22	1.87	3.92	买入

资料来源：wind，华鑫证券研究，截至2024年5月17日收盘价

## 2.2、行业重点公司估值水平和盈利预测

图表 10：行业重点关注公司估值水平及盈利预测

分类	证券代码	证券简称	市值 (亿元) 2024-05-17	ROE (%)	EPS			PE			PB	投资评级
					2022	2023E	2024E	2022	2023E	2024E		
Chiplet	300493.SZ	润欣科技	39.76	9.20	0.07	0.31	0.43	120.51	25.17	18.41	3.71	买入
EDA	688206.SH	概伦电子	61.51	-1.82	-0.13	0.18	0.23	-167.93	78.86	62.77	3.06	买入
LED	002449.SZ	国星光电	46.14	6.16	0.14	0.41	0.51	68.39	18.31	14.51	1.20	增持
	600363.SH	联创光电	141.03	11.33	0.75	1.23	1.66	45.62	25.27	18.65	3.44	买入
LED&SiC	600703.SH	三安光电	627.62	2.95	0.07	0.23	0.32	188.50	55.05	38.89	1.68	买入
LED 设备	688383.SH	新益昌	71.29	13.02	0.59	4.20	5.13	177.48	16.62	13.60	5.05	买入
PCB	002436.SZ	兴森科技	195.82	5.86	0.13	0.28	0.36	117.83	40.97	32.00	3.75	增持
	300903.SZ	科翔股份	28.90	0.00	-0.38	0.57	0.00	-26.19	12.35		1.36	买入
	603920.SH	世运电路	124.30	13.61	0.92	1.13	1.31	19.63	20.68	17.89	1.81	买入
	688020.SH	方邦股份	26.74	1.46	-0.85	0.64	1.25	-56.92	51.43	26.74	1.82	买入
半导体材料	605358.SH	立昂微	147.83	3.53	0.10	0.93	1.24	281.95	23.54	17.68	1.97	买入
	688126.SH	沪硅产业	363.73	1.45	0.07	0.16	0.20	255.07	85.18	67.36	2.74	增持
	688234.SH	天岳先进	228.13	2.77	-0.11	0.33	0.75	-620.97	162.95	71.07	4.37	买入
半导体设备	300812.SZ	易天股份	32.37	7.50	0.15	0.50	1.07	269.29	46.24	21.58	3.69	买入
	688012.SH	中微公司	810.50	10.34	2.88	3.23	4.08	53.26	40.46	32.06	4.51	买入
被动元件	000636.SZ	风华高科	143.93	3.23	0.15	0.76	0.98	91.11	16.39	12.75	1.20	买入
	002138.SZ	顺络电子	210.37	13.39	0.79	1.14	1.40	34.00	22.92	18.58	3.60	买入
	301099.SZ	雅创电子	32.04	13.10	0.67	1.99	3.24	76.38	20.03	12.37	3.16	增持
	603738.SH	泰晶科技	52.05	7.10	0.26	1.39	0.47	62.84	13.49	28.29	2.98	未评级
磁性材料	600366.SH	宁波韵升	67.59	6.50	-0.20	0.81	0.49	-37.98	7.52	12.48	1.14	未评级
电子化学品	300054.SZ	鼎龙股份	217.42	9.13	0.23	0.79	0.66	103.02	29.15	34.96	4.97	未评级
	300655.SZ	晶瑞电材	76.39	4.57	0.01	0.43	0.53	655.02	30.56	24.56	2.96	买入
	301489.SZ	思泉新材	37.03	8.87	0.95	1.89	2.47	79.90	33.97	26.08	3.68	增持
	688106.SH	金宏气体	90.20	11.51	0.65	0.81	1.01	37.24	22.95	18.30	2.92	买入
	688268.SH	华特气体	61.99	11.76	1.42	2.19	3.04	47.44	23.48	16.94	3.63	买入
	688371.SH	菲沃泰	38.68	5.70	-0.12	0.91	0.47	-142.17	12.68	24.64	1.97	未评级
封测	002156.SZ	通富微电	315.86	6.39	0.11	0.59	0.74	206.91	35.37	28.18	2.25	增持
	600584.SH	长电科技	464.71	8.20	0.82	1.32	1.82	36.31	19.62	14.29	1.77	买入
	688362.SH	甬矽电子	84.51	3.46	-0.23	0.25	0.61	-114.33	84.51	33.94	3.54	买入
	688372.SH	伟测科技	54.01	7.59	1.04	2.41	3.84	75.33	19.71	12.42	2.18	未评级
	688403.SH	汇成股份	67.37	7.53	0.23	0.28	0.33	44.94	29.29	24.50	2.19	增持
	300623.SZ	捷捷微电	118.76	7.99	0.30	0.45	0.61	53.33	35.99	26.63	3.35	买入
功率半导体	600460.SH	士兰微	311.68	2.91	-0.02	0.71	0.91	-1061.62	30.83	24.16	2.60	买入
	605111.SH	新洁能	113.90	9.80	1.08	1.40	1.81	34.91	27.18	21.13	3.10	买入
	688261.SH	东微半导	46.59	6.28	1.48	7.67	9.74	56.31	9.01	7.10	1.63	买入
光刻胶	688711.SH	宏微科技	36.22	10.06	0.76	1.70	2.59	54.32	14.04	9.19	3.26	买入
	603306.SH	华懋科技	66.56	9.00	0.74	1.61	1.97	36.53	12.68	10.33	1.99	买入
光芯片	688498.SH	源杰科技	115.37	3.85	0.23	1.64	2.15	648.84	83.00	63.05	5.46	买入
光学元件	002036.SZ	联创电子	79.07	7.48	-0.93	0.80	0.53	-10.99	9.34	14.06	2.95	未评级
	002222.SZ	福晶科技	111.62	14.90	0.49	0.65	0.82	60.38	40.01	31.80	7.46	买入

	002456.SZ	欧菲光	269.10	0.00	0.02	0.29	0.61	368.97	28.18	13.52	7.84	增持
	301421.SZ	波长光电	49.41	16.70	0.47	0.75	1.08	133.47	57.46	39.53	4.14	增持
	603297.SH	永新光学	79.32	15.26	2.12	2.70	3.54	46.93	26.44	20.13	4.26	增持
	688010.SH	福光股份	29.06	0.00	-0.43	0.43	0.61	-56.58	44.03	30.92	1.72	买入
	688195.SH	腾景科技	36.43	7.92	0.32	0.57	0.80	111.76	49.22	35.02	4.04	买入
	688502.SH	茂莱光学	51.16	4.78	0.88	1.92	2.66	245.21	50.65	36.54	4.40	增持
	688167.SH	炬光科技	59.78	3.89	1.00	1.52	2.56	113.77	43.63	25.88	2.56	买入
环保设备III	688376.SH	美埃科技	42.75	12.05	1.29	1.73	2.23	29.47	18.43	14.25	2.57	增持
	002008.SZ	大族激光	222.01	9.25	0.78	2.25	1.16	26.58	9.38	18.18	1.42	未评级
激光设备	688025.SH	杰普特	41.94	9.20	1.13	2.23	3.34	81.85	19.87	13.23	2.13	买入
	688170.SH	德龙激光	28.91	4.50	0.38	0.55	0.93	103.36	50.72	30.11	2.24	增持
家电零部件	300475.SZ	香农芯创	160.97	15.53	0.83	0.85	1.01	40.94	41.27	34.99	6.09	增持
金属制品	873693.BJ	阿为特	14.85	10.10	0.32	0.48	0.54	131.56	42.42	38.06	4.39	增持
军工电子	300045.SZ	华力创通	129.42	2.20	0.03	0.08	0.15	915.23	235.31	129.42	7.44	买入
	002387.SZ	维信诺	98.38	-20.20	-2.68	-0.28	0.03	-4.18	-25.29	209.32	1.34	增持
	002876.SZ	三利谱	42.97	7.00	0.25	1.40	2.31	149.37	17.61	10.71	1.83	增持
面板	300088.SZ	长信科技	123.48	6.04	0.10	0.31	0.38	67.99	16.25	13.07	1.49	增持
	300909.SZ	汇创达	37.81	0.00	0.54	2.57	2.09	57.37	9.72		1.94	未评级
	603773.SH	沃格光电	48.42	9.50	-0.03	0.89	1.10	-1278.40	31.85	25.75	3.53	买入
	300661.SZ	圣邦股份	358.73	10.87	0.60	0.98	1.57	148.18	77.82	48.41	9.10	买入
	300782.SZ	卓胜微	469.65	12.46	2.10	2.91	3.45	67.06	30.28	25.51	4.69	买入
	603160.SH	汇顶科技	282.82	8.27	0.36	1.16	1.47	191.74	53.16	42.02	3.43	增持
	688052.SH	纳芯微	131.70	-0.94	-2.14	4.14	5.01	-77.88	22.51	18.57	2.15	买入
模拟 IC	688173.SH	希荻微	46.67	-10.10	-0.13	0.13	0.48	-132.82	84.86	23.69	2.68	买入
	688220.SH	翱捷科技-U	167.66	-6.37	-1.21	-0.38	0.13	-58.25	-104.78	304.83	2.70	买入
	688368.SH	晶丰明源	44.76	6.20	-1.45	1.74	3.30	-74.44	41.07	21.52	3.37	增持
	688458.SH	美芯晟	31.40	2.80	0.38	1.90	2.78	204.21	20.66	14.15	1.54	买入
	688515.SH	裕太微-U	51.70	-11.53	-1.88	0.99	1.82	-52.66	65.44	35.41	2.92	买入
	688798.SH	艾为电子	128.09	3.77	0.22	1.33	2.00	313.98	58.22	38.58	3.49	买入
膜材料	300806.SZ	斯迪克	42.02	7.20	0.12	0.56	1.08	113.75	16.48	8.59	1.92	买入
品牌分销	002416.SZ	爱施德	136.82	11.31	0.53	0.57	0.67	17.57	19.41	16.58	2.23	买入
品牌整机	688036.SH	传音控股	1106.12	29.06	6.87	8.03	9.40	20.16	17.08	14.58	5.57	买入
其他电子III	688662.SH	富信科技	22.78	7.30	-0.14	0.71	0.92	-251.68	36.16	28.13	3.43	增持
其他计算机设备	300042.SZ	朗科科技	47.94	5.81	-0.22	0.38	0.48	-160.27	63.91	49.93	4.26	买入
	872190.BJ	雷神科技	13.83	8.10	0.34	0.76	0.98	86.75	18.44	14.26	1.64	增持
其他专用设备	688630.SH	芯碁微装	85.42	12.43	1.36	2.15	3.12	62.57	30.29	20.89	4.18	增持
软件	600225.SH	卓朗科技	85.97	0.00	-0.04	0.08	0.13	-106.60	31.61	19.32	4.15	买入
	300223.SZ	北京君正	291.30	5.69	1.12	2.36	2.93	57.95	25.60	20.62	2.47	买入
	300458.SZ	全志科技	122.31	5.32	0.04	0.27	0.51	624.24	71.11	37.98	4.18	增持
	301308.SZ	江波龙	369.18	16.71	-2.01	0.72	1.24	-45.91	123.89	71.97	5.69	增持
	603501.SH	韦尔股份	1208.72	12.11	0.46	2.38	3.42	233.44	41.75	29.09	5.81	买入
数字 IC	603893.SH	瑞芯微	229.75	10.65	0.32	0.86	1.20	196.44	63.64	45.86	7.34	买入
	603986.SH	兆易创新	552.67	6.75	0.24	2.37	3.13	382.37	34.98	26.44	3.60	买入
	688018.SH	乐鑫科技	83.71	9.24	1.69	2.38	3.20	61.06	43.60	32.32	4.64	买入
	688099.SH	晶晨股份	246.31	12.05	1.20	1.83	2.96	52.36	32.24	19.91	4.37	买入
	688110.SH	东芯股份	98.36	2.24	-0.69	0.80	1.23	-49.72	27.63	18.01	2.87	买入

	688123.SH	聚辰股份	84.75	15.06	0.63	2.07	2.97	96.50	25.76	17.99	4.25	买入
	688213.SH	思特威-W	189.32	7.32	0.04	1.01	1.33	1563.41	46.63	35.65	5.00	买入
	688259.SH	创耀科技	36.69	5.40	0.73	1.89	2.44	92.99	24.30	18.81	2.43	增持
	688262.SH	国芯科技	67.30	0.00	-0.50	1.71	2.44	-58.42	16.41	11.50	2.85	增持
	688332.SH	中科蓝讯	64.62	8.40	2.10	2.88	3.80	35.96	18.68	14.17	1.74	买入
	688385.SH	复旦微电	198.64	14.13	0.88	2.19	2.62	43.98	11.10	9.28	4.67	买入
	688486.SH	龙迅股份	58.53	9.19	1.48	2.08	3.03	80.10	40.65	27.87	4.08	增持
	688521.SH	芯原股份	148.17	0.61	-0.59	0.06	0.16	-84.24	510.94	182.93	5.94	增持
	688608.SH	恒玄科技	152.68	4.49	1.03	2.51	4.19	149.79	50.73	30.35	2.50	买入
	688728.SH	格科微	368.24	3.21	0.02	0.10	0.18	1103.41	138.96	76.72	4.67	增持
	688766.SH	普冉股份	88.26	8.08	-0.64	2.02	3.26	-153.27	58.07	35.73	4.44	买入
通信工程及服务	603220.SH	中贝通信	96.58	12.23	0.43	0.76	0.93	79.15	79.15	30.86	5.09	买入
通信网络设备及器件	300308.SZ	中际旭创	1370.06	26.66	2.71	6.02	8.03	41.71	28.34	21.24	8.72	增持
	300394.SZ	天孚通信	562.71	31.63	1.85	3.21	4.85	49.52	44.34	29.40	16.12	买入
通信线缆及配套	600487.SH	亨通光电	370.01	9.50	0.87	1.09	1.30	13.68	13.80	11.51	1.41	增持
通信终端及配件	832149.BJ	利尔达	15.52	10.55	-0.01	0.33	0.46	-513.72	11.24	8.04	2.03	增持
	002241.SZ	歌尔股份	577.15	6.45	0.32	1.70	0.83	66.05	9.94	20.30	1.88	未评级
	002993.SZ	奥海科技	93.74	11.73	1.60	2.85	3.43	23.85	11.93	9.91	1.91	买入
	300115.SZ	长盈精密	129.68	11.07	0.07	0.58	0.74	186.10	18.45	14.62	2.12	增持
	300136.SZ	信维通信	186.74	10.25	0.54	1.10	1.42	43.79	17.50	13.60	2.61	买入
	300684.SZ	中石科技	48.07	7.43	0.25	0.83	0.95	87.27	19.31	16.87	2.50	买入
消费电子零部件及组装	300709.SZ	精研科技	51.62	12.07	0.89	1.53	1.88	34.91	18.18	14.75	2.53	增持
	300793.SZ	佳禾智能	45.72	6.50	0.39	1.00	0.61	55.38	13.49	22.07	1.87	未评级
	600745.SH	闻泰科技	392.11	4.69	0.95	3.62	2.12	44.52	8.70	14.85	1.10	未评级
	601231.SH	环旭电子	338.18	12.70	0.88	1.99	1.29	17.14	7.70	11.82	2.01	未评级
	603296.SH	华勤技术	517.06	13.58	3.74	3.98	4.82	21.38	17.97	14.84	2.42	买入
	603380.SH	易德龙	33.72	14.10	0.83	2.03	1.72	30.91	10.28	12.17	2.44	未评级
	688661.SH	和林微纳	44.95	0.00	-0.23	1.92	3.49	-196.67	26.13	14.36	3.69	买入
	688283.SH	坤恒顺维	35.18	10.83	1.04	2.07	1.80	66.19	20.22	23.23	3.63	未评级
	300354.SZ	东华测试	54.22	22.35	0.63	1.95	2.57	78.30	20.08	15.23	7.87	买入
	300567.SZ	精测电子	164.58	6.84	0.54	1.51	2.02	162.37	39.19	29.34	4.94	买入
仪器仪表	688112.SH	鼎阳科技	50.61	11.74	0.98	1.66	2.27	41.06	19.24	14.06	3.18	买入
	688337.SH	普源精电	56.26	5.20	0.58	1.42	2.02	75.23	21.98	15.46	1.95	买入
	688628.SH	优利德	46.88	16.46	1.46	2.33	3.08	27.06	18.03	13.67	3.78	买入

资料来源: Wind, 华鑫证券研究, 截至 2024 年 5 月 17 日收盘价

### 3、行业高频数据

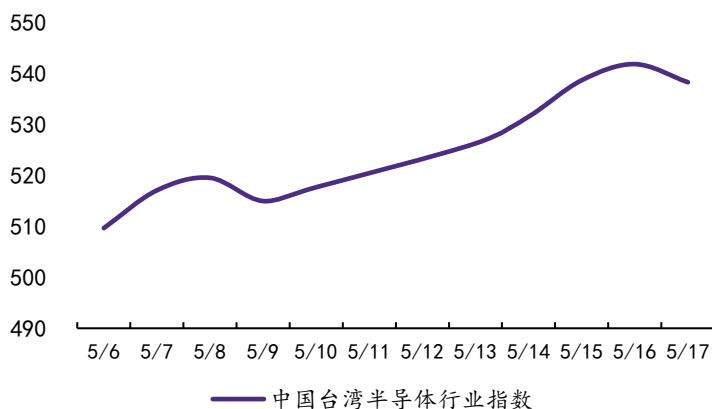
#### 3.1、台湾电子行业指数跟踪

行业指标上，我们依次选取台湾半导体行业指数、台湾计算机及外围设备行业指数、台湾电子零组件行业指数、台湾光电行业指数，来观察行业整体景气。日期上，我们分别截取各指数近两周的日度数据、近两年的周度数据，来考察不同时间维度的变化。

近两周：环比看，5月6日-5月17日两周，台湾半导体行业指数、台湾计算机及外围设备行业指数呈现上涨态势；台湾电子零组件行业指数以及台湾光电行业指数呈现先降后升的态势。

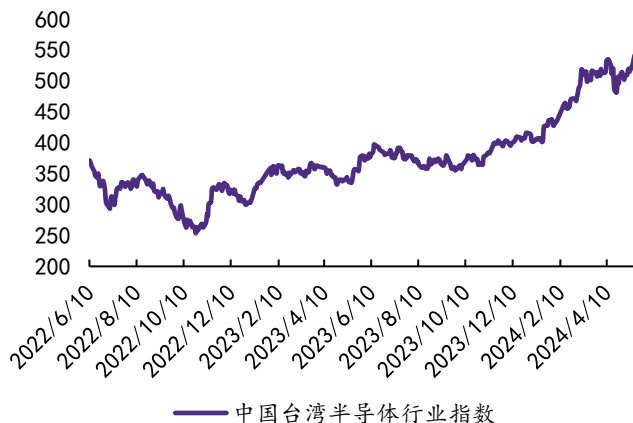
近两年：更长时间维度看，台湾电子行业各细分板块指数经过2022年震荡下行后，上半年整体呈现震荡上行趋势，但进入下半年以来复苏放缓。其中台湾计算机及外围设备行业指数2023年7月以来呈现先降后升态势，台湾电子零组件行业指数、台湾半导体行业指数近期有所回升，台湾光电行业指数则在低位震荡。

图表 11：台湾半导体行业指数近两周走势



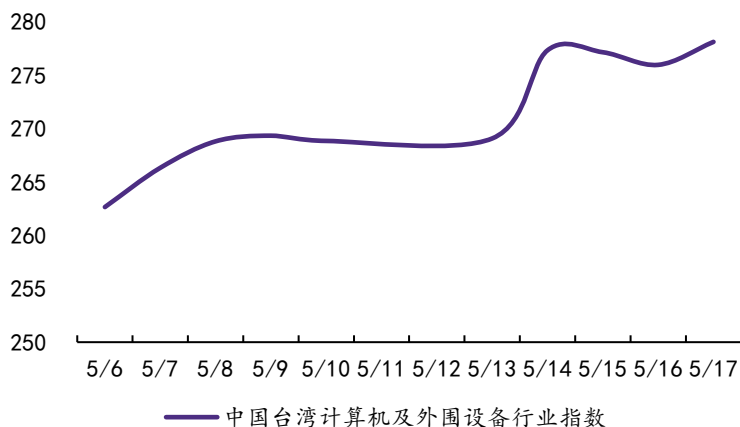
资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 12：台湾半导体行业指数近两年走势



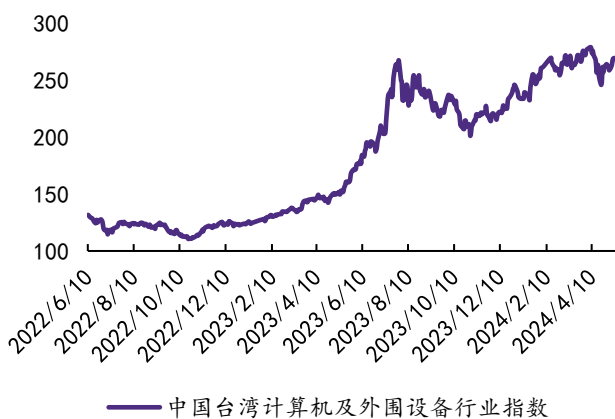
资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势



资料来源：wind，华鑫证券研究

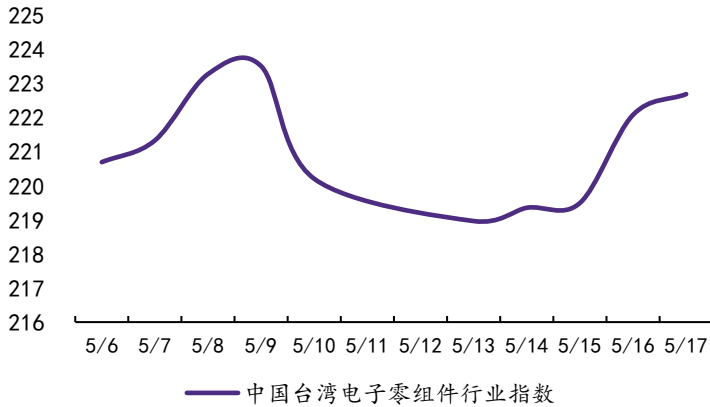
图表 14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势



资料来源：wind，华鑫证券研究

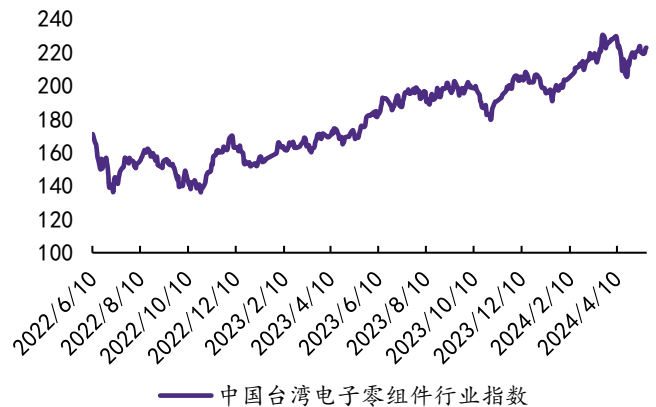


图表 15: 台湾电子零组件行业指数近两周走势



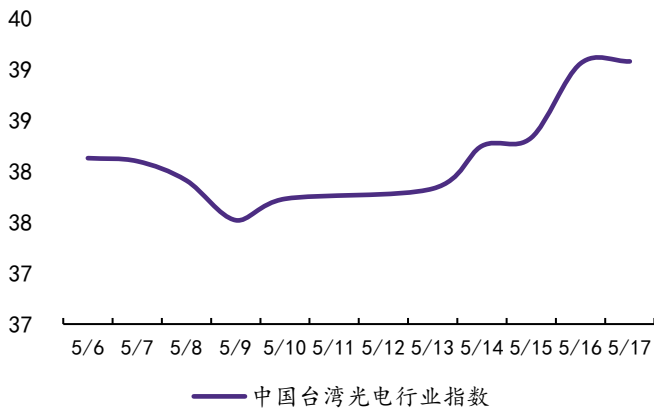
资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 16: 台湾电子零组件行业指数近两年走势



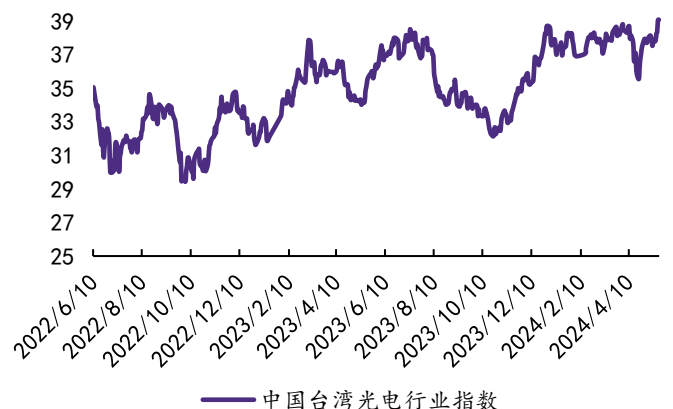
资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 17: 台湾光电行业指数近两周走势



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 18: 台湾光电行业指数近两年走势

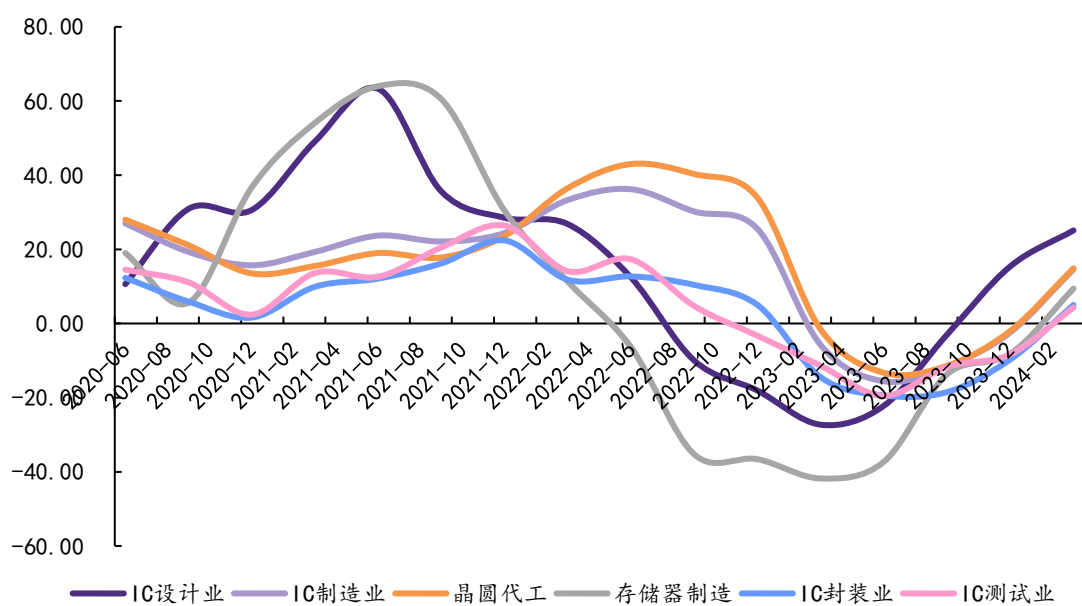


资料来源: wind, 华鑫证券研究

我们可以通过中国台湾 IC 产值同比增速, 将电子各板块合在一起观察:

中国台湾 IC 各板块产值同比增速自 2021 年以来持续下降, 从 2023 年 Q2 开始陆续有所反弹, 各板块产值降幅均有所收窄。IC 板块整体表现不佳, 主要因为消费电子需求差, 导致 IC 设计下滑, 加之 2021 年缺货、涨价导致的 2022 年库存水位上升。但随着 AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动, 2024 年需求开始逐步回升。

图表 19: 中国台湾 IC 各板块产值当季同比变化 (%)

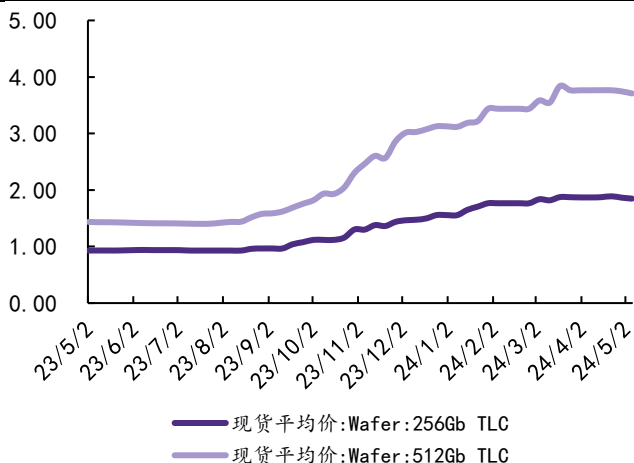


资料来源: wind, 华鑫证券研究

### 3.2、电子行业主要产品指数跟踪

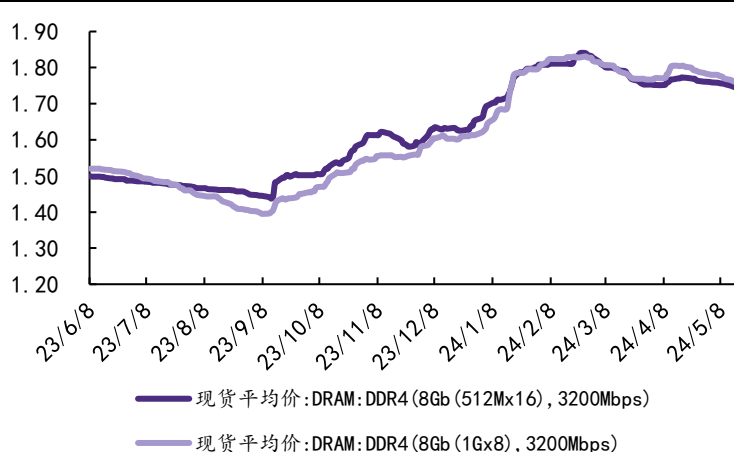
受益于上游头部供应商减产以及 2023 年第四季度消费电子市场有所恢复，存储芯片价格整体呈现回升趋势。NAND 方面：Wafer:512Gb TLC 现货平均价从 2023 年 7 月底开始回升，2024 年 5 月 6 日价格为 3.71 美元。DRAM 方面：DRAM:DDR4 8Gb 512mx16 3200Mbps 现货平均价从 2023 年 9 月中旬开始持续上涨，2024 年 3 月以来价格略有下滑，5 月 17 日价格为 1.75 美元。

图表 20: NAND 价格 (单位: 美元)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

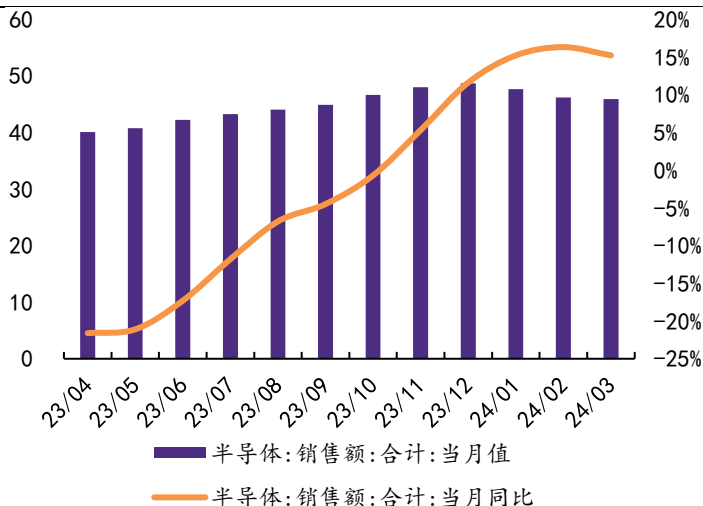
图表 21: DRAM 价格 (单位: 美元)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

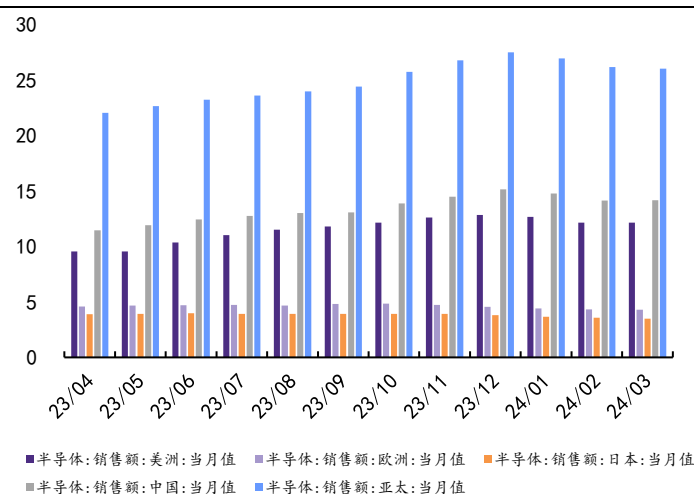
全球半导体销售额 2023 年 H1 整体呈同比下降态势。2024 年 3 月，全球半导体当月销售额为 459.1 亿美元，同比增长 15.2%，其中中国销售额为 141.4 亿美元，环比增长 0.07%，占比达 30.8%。此外，从 2023 年 3 月开始全球半导体当月销售额逐月递增，自 2023 年 4 月以来，全球半导体销售额同比降幅逐月收窄，直至 2023 年 11 月份开始全球半导体销售额同比变动转正并持续扩大。

图表 22: 全球半导体销售额 (单位: 十亿美元)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 23: 全球分地区半导体销售额 (单位: 十亿美元)

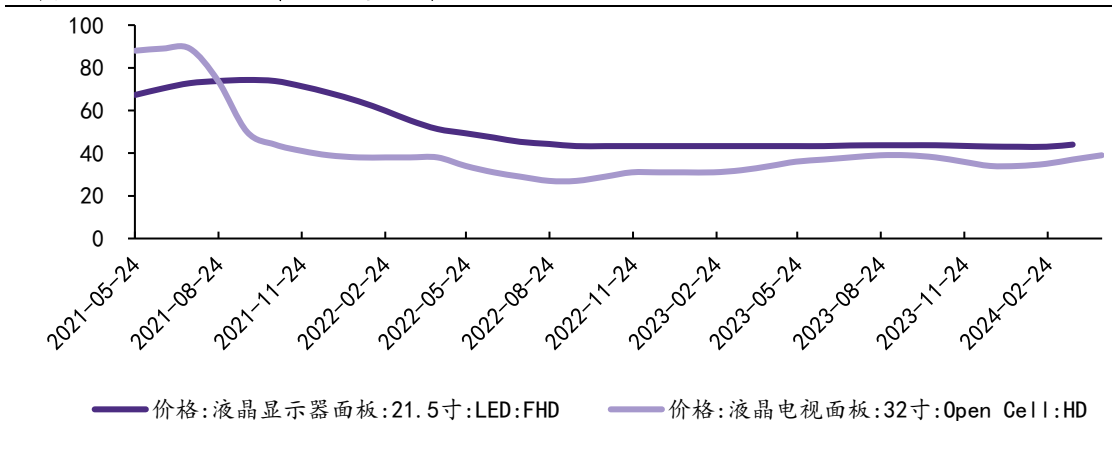


资料来源: wind, 华鑫证券研究

面板价格保持稳定态势。面板价格自 2021 年 7 月以来，价格持续下降，目前价格整体保持稳定，其中液晶电视面板:32 寸:Open Cell:HD 价格近期有所回升，2024 年 4 月 23 日

为 39 美元/片，液晶显示器面板:21.5 寸:LED:FHD 价格自 2022 年 8 月 23 日以来，价格稳定在 43.3 美元/片，2024 年 3 月 22 日价格略有上升，为 44.00 美元/片。

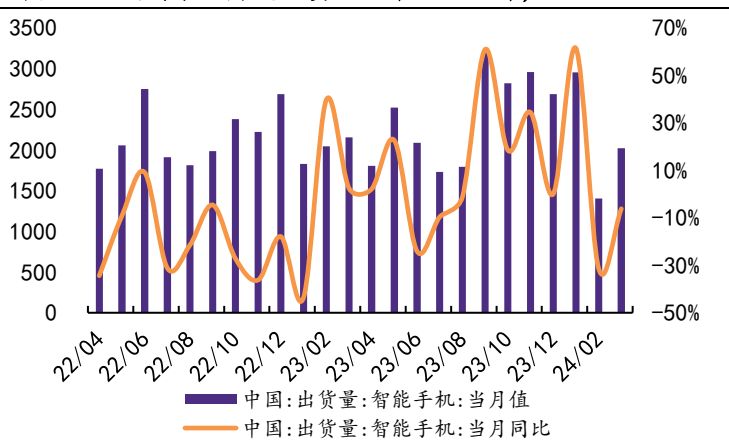
图表 24: 面板价格 (单位: 美元/片)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

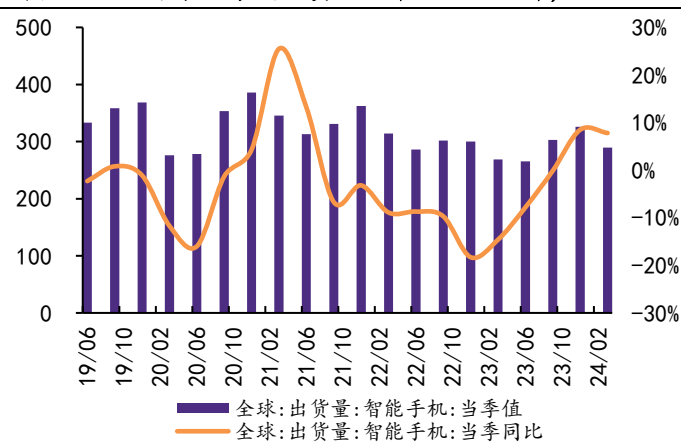
2023H2, 国内智能手机出货量同比转正。但 2024 年 3 月国内手机出货量同比下跌 6.2%。全球范围内, 2023 年智能手机出货量同比下滑 3.3%, 但分季度来看, 全球智能手机出货量前三季度同比降幅逐季收窄, 2023 年四季度同比变动转正。主要由于两个方面, 一方面是手机硬件缺乏创新, 发达经济体以及中国 5G 周期结束后, 消费者换机周期拉长; 另一方面中国疫情之后经济复苏不及预期, 消费者需求疲软。

图表 25: 国内手机月度出货量 (单位: 万部, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

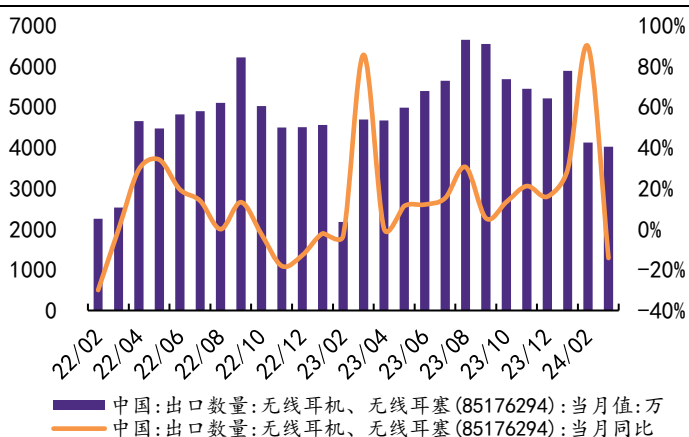
图表 26: 全球手机季度出货量 (单位: 百万部, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

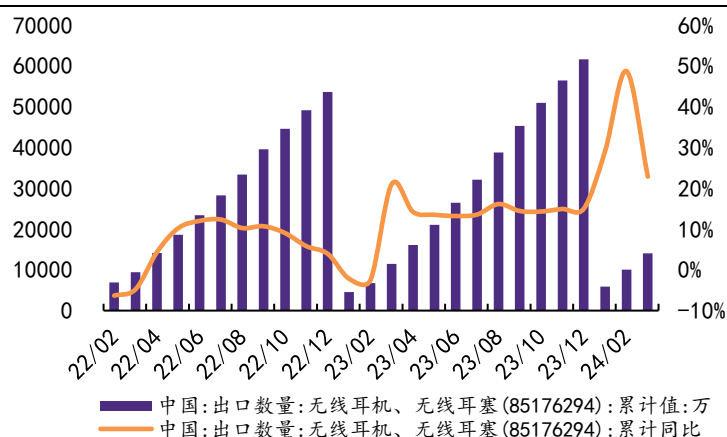
无线耳机方面, 国内海关出口数据显示, 2023 年以来呈现复苏趋势, 全年自 2023 年 2 月以来无线耳机月度出口量同比增幅持续为正, 且自 2023 年 9 月以来同比增幅持续扩大。无线耳机技术已经充分成熟, 相对于手机消费, 无线耳机普及还有空间, 随着无线耳机传感器的增多, 产品体验感会更加出色, 叠加价值量相对手机较小, 换机周期会显著快于手机。因此, 随着国内的放开和经济复苏, 我们继续看好无线耳机这类可穿戴设备的成长。

图表 27: 无线耳机月度出口量 (单位: 个, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

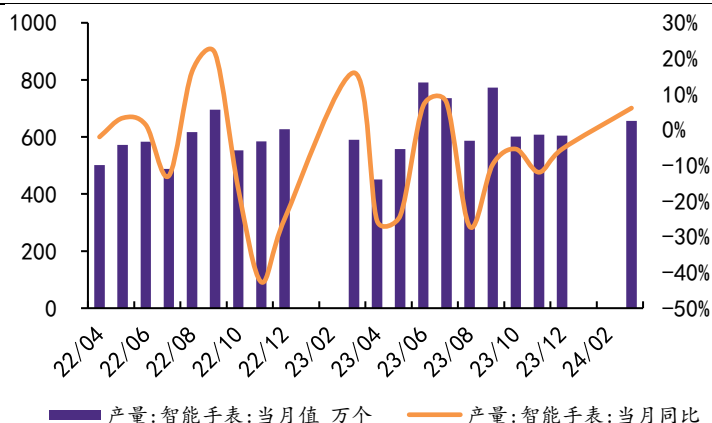
图表 28: 无线耳机累计出口量 (单位: 个, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

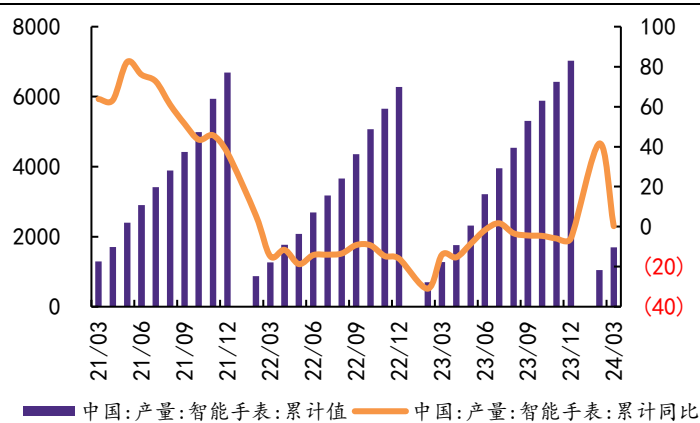
中国智能手表 2023 年全年累计产量同比下降 5.90%; 但进入 2024 年之后出现反弹, 第一季度智能手表累计产量同比增长 24.7%, 打破近两年的持续下滑趋势。展望 2024 年, 随着生成式 AI 与终端硬件的结合, 智能手表有望集成更多 AI 功能, 从而为市场增长开辟新途径。

图表 29: 中国智能手表月度产量 (单位: 万个, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

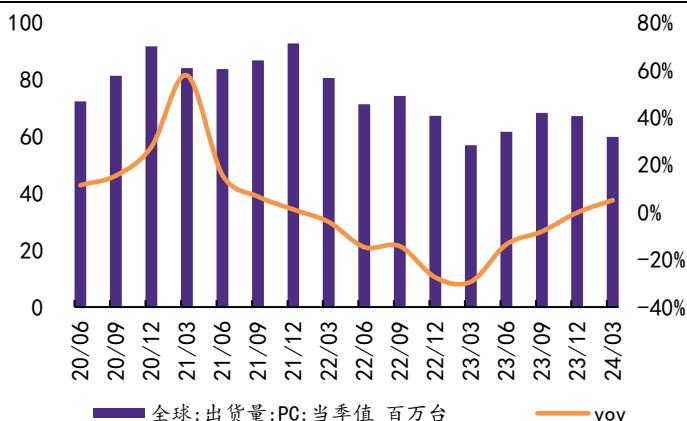
图表 30: 中国智能手表累计产量 (单位: 万个, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

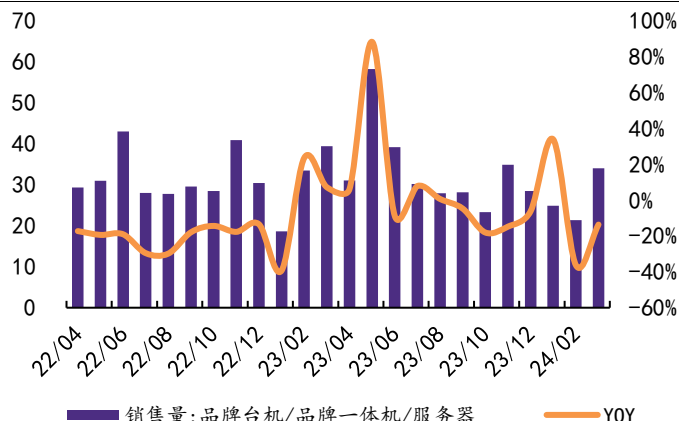
个人电脑方面, 2020-2021 年疫情带来居家办公需求快速上升, 推动 PC 重回增长轨道, 但疫情带来的短期复苏结束后 PC 重回弱势趋势, 在 2022Q2 开始进入下行区间, 2022Q2 全球 PC 出货量同比微增 0.53%, 远低于 Q1 的 11.44% 的增速, 2023H1, 全球 PC 出货量继续下降, 一季度同比下降 29.16%, 二季度同比下降 17.16%; 2023Q3, 出货量同比下降 5.47%, 降幅有所收窄; 2023Q4, 出货量同比下降 2.94%, 降幅进一步收窄。2023 年, 品牌台式机/品牌一体机/服务器出货量累计达 392.57 万件, 同比增长 2.62%。AI 大模型落地给 PC 产业链带来新的创新驱动动力, 另外 PC 换机潮的到来, 预计 2024 年 PC 市场将恢复增长。

图表 31: 全球 PC 季度出货量 (单位: 百万台, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

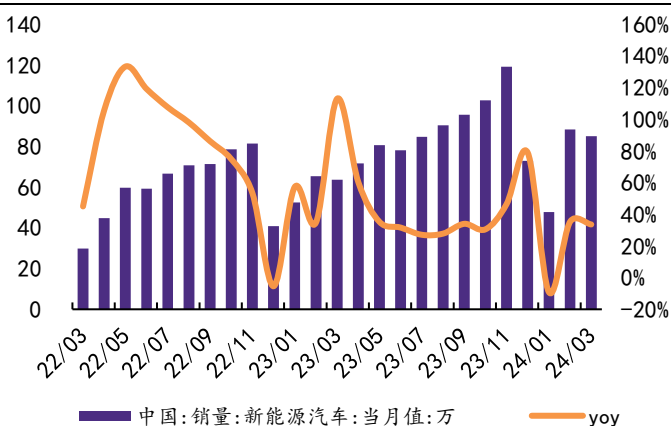
图表 32: 中国台机/服务器月度出货量 (单位: 万台)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

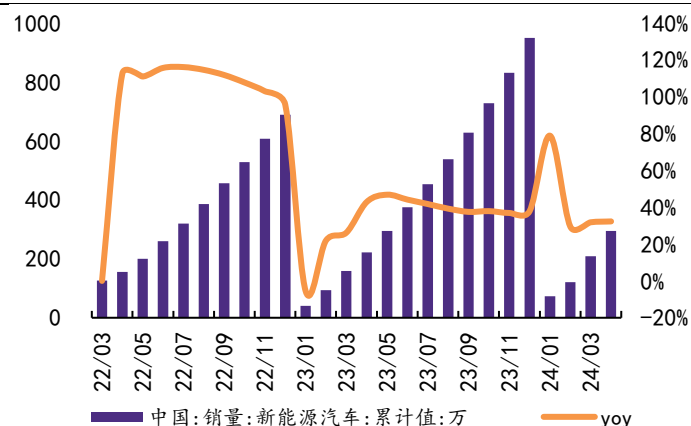
随着汽车智能化和电动化带来更好的用户体验以及国家大力推广新能源车, 新能源车销量依旧保持强劲增长势头, 2023 年 1-4 季度分别取得 26.18%、60.92%、28.68%、38.68% 的同比增速。2023 年全年, 新能源汽车累计销量达到 949.52 万辆, 同比增长 37.88%。2024 年第一季度, 新能源汽车销售量同比增长 31.82%。新能源车产业链已经发展成熟, 汽车电动化和智能化带来的电子零部件和汽车半导体的需求将持续保持高成长态势。

图表 33: 中国新能源车月度销售量 (单位: 万辆, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 34: 中国新能源车累计销售量 (单位: 万辆, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

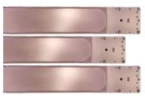







## 4、近期新股

### 4.1、欧莱新材（688530.SH）：高性能溅射靶材提供商

公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和 ITO 靶等，产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。

公司主要代表性客户包括京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电、深超光电和中电熊猫等半导体显示面板行业主流厂商，超声电子、莱宝高科、南玻集团、长信科技和 TPK（宸鸿科技）等知名触控屏厂商，AGC（旭硝子）、南玻集团、Pilkington（皮尔金顿）和旗滨集团等建筑玻璃龙头厂商。此外，公司持续推动产品研发与技术升级，不断拓展产品应用范围，目前已进入越亚半导体、SKHynix（海力士）等知名半导体厂商的集成电路封装材料供应体系和万顺新材、宝明科技、腾胜科技等新能源电池复合集流体正负极材料和镀膜设备核心厂商的供应链，并应用于中建材等大型新材料开发商的太阳能薄膜电池中。

图表 35：欧莱新材主要产品概况

产品类型	产品名称	产品图例	产品简介	主要应用领域
铜靶	平面铜靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>具有电阻率低、抗电迁移性优、稳定性佳等特点</li> </ul>	半导体显示、触控屏、装饰镀膜、建筑玻璃、集成电路封装、新能
	旋转铜靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>可用于制备 TFT 阵列电极和互连线膜层、触控屏导线层、彩膜层、光学膜层、陶瓷基板覆铜层、新能源电池的集流体复合铜箔</li> <li>主要产品纯度在 4N 以上，晶粒度在 100 μm 以下，平面铜靶绑定焊合率在 98% 以上，旋转铜靶直线度在 0.1mm/m 以下</li> </ul>	
铝靶	平面铝靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>具有电阻率低、耐腐蚀性强、蚀刻性能佳等特点</li> </ul>	半导体显示、装饰镀膜、太阳能电池、新能源电池
	旋转铝靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>可用于制备 TFT 阵列电极和互连线膜层、彩膜层、光学膜层、太阳能薄膜电池导线层、新能源电池的集流体复合铝箔</li> <li>主要产品纯度在 5N 以上，晶粒度在 200 μm 以下，平面铝靶绑定焊合率在 95% 以上，旋转铝靶直线度在 0.1mm/m 以下</li> </ul>	
钼及钼合金靶	平面钼及钼合金靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>具有熔点高、电导率高、抗氧化性高、比阻抗低和膨胀系数低等特点</li> </ul>	半导体显示、触控屏
	旋转钼及钼合金靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>可用于制备 TFT 阵列阻隔层、触控屏电极和导线阻隔层</li> <li>主要产品纯度在 3N5 以上，相对密度在 99.7% 以上</li> </ul>	
ITO 靶	平面 ITO 靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>具有透光率高、导电性能优、刻蚀性能佳等特点</li> </ul>	触控屏、半导体显示
	旋转 ITO 靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>可用于制备触控屏透明导电层、TFT 阵列透明电极、彩色滤光片</li> <li>主要产品纯度在 4N 以上，相对密度在 99.7% 以上</li> </ul>	

	铝钨合金靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 可用于制备触控屏导线层</li> <li>· 主要产品纯度在 4N 以上</li> </ul>	触控屏
	锌锡合金靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 可用于制备光学膜层</li> <li>· 主要产品纯度在 3N 以上</li> </ul>	建筑玻璃
其他	硅铝合金靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 可用于制备保护膜层</li> <li>· 主要产品纯度在 3N 以上</li> </ul>	建筑玻璃
	镍铬合金靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 可用于制备保护膜层</li> <li>· 主要产品纯度在 2N8 以上</li> </ul>	建筑玻璃
	钛靶		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 可用于制备彩膜层</li> <li>· 可用于制备陶瓷基板的阻隔层</li> </ul>	装饰镀膜、集成电路封装

资料来源：欧莱新材招股书，华鑫证券研究

2023 年实现营收 4.76 亿元，2019-2023 年 CAGR 为 31.13%；2023 年实现归母净利润 0.49 亿元，2020-2023 年 CAGR 为 30.59%。公司 2019-2023 年分别实现营业收入 1.61 亿元、2.46 亿元、3.82 亿元、3.92 亿元、4.76 亿元，2020-2023 年 YOY 依次为 52.75%、55.44%、2.50%、21.50%；2020-2023 年分别实现归母净利润 0.22 亿元、0.50 亿元、0.35 亿元、0.49 亿元，2020-2023 年 YOY 依次为 370.68%、129.07%、-30.03%、39.69%。公司抓住半导体显示、触控屏、建筑玻璃等下游行业快速发展的良好市场机遇，不断拓展产品应用领域，持续深化与下游知名头部客户间的合作关系，营业收入持续增长。

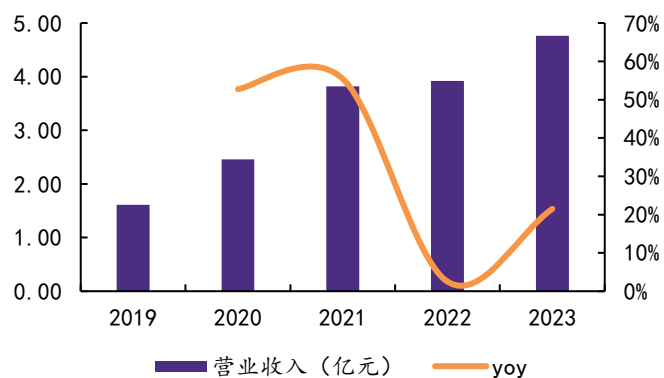
近年来，随着电子与信息产业国产化进程加快，液晶显示器、触控屏等产业呈现出向中国大陆进行产能转移的趋势，国内溅射靶材行业在国家产业政策的扶持下逐渐突破关键技术，形成了一批具有较强市场竞争力的本土溅射靶材厂商。

公司积极推动高性能溅射靶材国产化进程，基于下游市场需求变化和技术发展趋势对前沿领域溅射靶材的工艺与技术开展研发工作，成功进入国内外知名半导体显示、触控屏等下游企业的供应链，有效保障了国内重点行业上游关键原材料的自主可控及供应安全，助力关键领域溅射靶材实现进口替代。

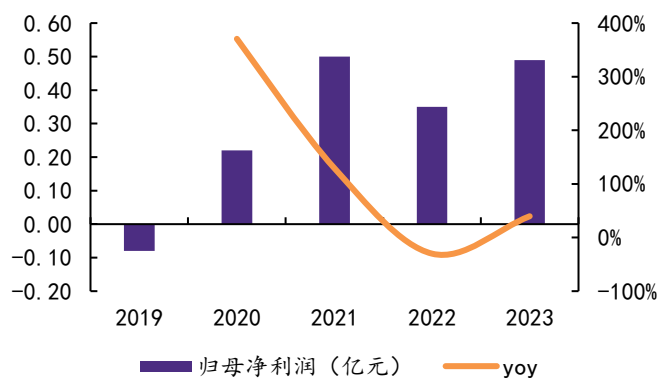
随着高性能溅射靶材国产化进程加速，公司市场份额不断提升，在部分优势领域已成功实现进口替代。公司应用于半导体显示领域的溅射靶材的多项核心技术指标已达到国内外同类产品先进水平，具备与国内外厂商竞争的技术实力，产品广泛应用于京东方、华星光电、惠科等下游行业知名厂商的高世代显示面板生产线中，树立了良好的市场口碑，为公司新产品的市场推广奠定了坚实的基础。根据中国电子材料行业协会的证明，按销售额统计，2021 年公司平面显示用铜靶产品出货在国产厂商中排名位居前列。



图表 36: 欧莱新材营业收入 (亿元)



图表 37: 欧莱新材归母净利润 (亿元)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

资料来源: wind, 华鑫证券研究

## 4.2、灿芯股份（688691.SH）：一站式芯片定制服务供应商

公司是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系。

依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市、高性能计算等行业。公司是国家级专精特新“小巨人”企业，并入选建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单(第二批第一年)。公司凭借技术和服务的优异表现，获得了“中国半导体创新产品和技术奖”、“中国半导体市场最佳设计企业奖”、“上海市浦东新区科学技术奖”、“2021 年度最具影响力 IC 设计企业”等多项荣誉奖项，并被权威媒体《电子工程专辑》(EE Times)评选为“全球 60 家最受关注的半导体初创公司”。

图表 38：灿芯股份产品应用情况

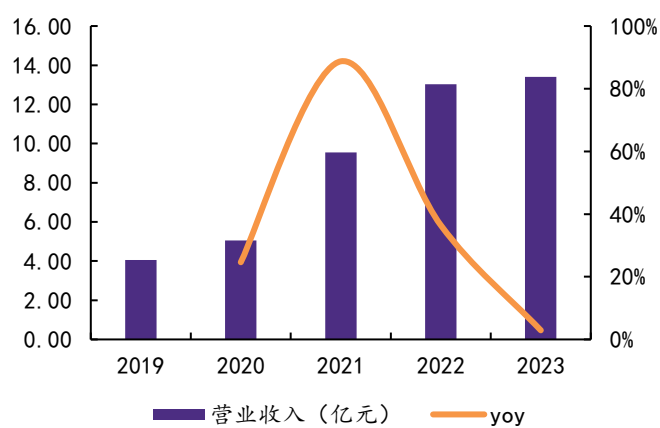
主要产品	服务内容	主要客户	终端应用
一站式芯片定制服务 功能性单丝	包括芯片定义、IP 选型及授权、架构设计、逻辑设计、物理设计、设计数据校验、流片方案设计等全流程芯片设计服务。公司在为客户提供芯片设计服务后，根据客户需求可继续为其提供芯片量产服务自用、厨卫	系统厂商，以及芯片设计公司	物联网 工业控制 消费电子 网络通信 智慧城市 人工智能 高性能计算

资料来源：灿芯股份招股意向书，华鑫证券研究

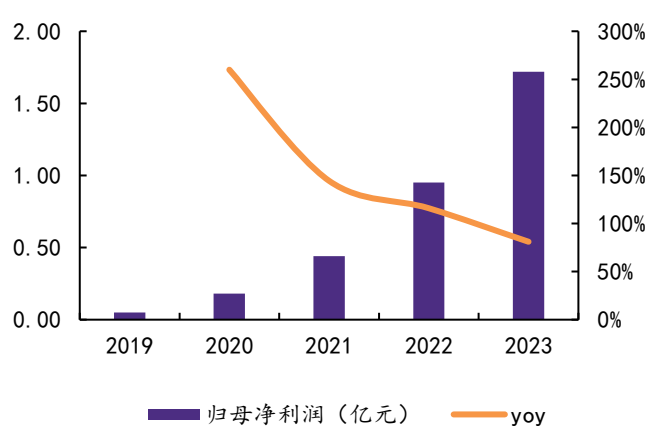
2023 年实现营收 13.41 亿元，2019-2023 年 CAGR 为 34.81%；2023 年实现归母净利润 1.72 亿元，2019-2023 年 CAGR 为 142.18%。公司 2019-2023 年分别实现营业收入 4.06 亿元、5.06 亿元、9.55 亿元、13.03 亿元、13.41 亿元，2020-2023 年 YOY 依次为 24.63%、88.74%、36.44%、2.92%；2019-2023 年分别实现归母净利润 0.05 亿元、0.18 亿元、0.44 亿元、0.95 亿元、1.72 亿元，2020-2023 年 YOY 依次为 260.00%、144.44%、115.91%、81.05%。

公司主营业务收入保持快速增长趋势，主要原因为：（1）随着逻辑工艺与特色工艺推陈出新，集成电路器件线宽不断缩小，设计风险与设计成本大幅增加，芯片定制服务整体行业需求将持续增长；（2）终端应用市场快速发展，芯片定制服务需求保持旺盛；（3）公司芯片设计能力持续提升，技术和市场竞争力不断加强；（4）公司能够快速满足客户对于芯片“自主、安全、可控”的迫切需求。

图表 39: 灿芯股份营业收入 (亿元)



图表 40: 灿芯股份归母净利润 (亿元)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

资料来源: wind, 华鑫证券研究

## 5、行业动态跟踪

### 5.1、半导体

#### 三星、SK 海力士将止供应，DDR3 价格大涨 20%

5 月 13 日消息，据《经济日报》报道，全球前两大 DRAM 供应商韩国三星电子和 SK 海力士正全力发展高带宽内存（HBM）与主流 DDR5 规格内存，今年下半年起将停止供应 DDR3 DRAM，引发市场抢货潮，导致近期 DDR3 价格大涨，最高涨幅达 20%，且下半年报价可能还会继续上涨。

业界有消息称，为发展 HBM 与 DDR5 的策略，三星已经通知客户将在第 2 季底停产 DDR3；至于 SK 海力士方面，则更早在去年底将大陆无锡厂将 DDR3 制程转为 DDR4，等同于不再供货 DDR3；而美光为扩充 DDR5、HBM 产能，也大幅减少 DDR3 供应量。

随着全球两大内存巨头退出 DDR3 市场，这对于主攻 DDR3 的华邦电子、晶豪科技及钰创等中国台湾 DRAM 厂有利，相关台厂有望受益于这轮转单商机及涨价效益，推动业绩迅速回温。

业界人士分析，AI 商机持续爆发带动下，英伟达（NVIDIA）、AMD 等 AI 芯片巨头出货大幅成长，并疯抢 AI 芯片必备的 HBM。放眼当下能供应高频宽内存的厂商，仅 SK 海力士、美光、三星等三家国际内存业者，由于需求又急又猛，三大内存厂不仅今年 HBM 产能已全被包走，明年相关产能也已销售一空。

由于 HBM 成为了当前市场的当红炸子鸡，“有多少货都有人愿意出价买”，让 SK 海力士、美光、三星获利大增，今年重点都聚焦 HBM 产能扩建。

不仅如此，由于英特尔、AMD 等 PC 平台大厂将在下半年推出的新处理器，将全面支持 DDR5 规格 DRAM。三大国际内存芯片厂在拓大 HBM 产能，又要冲刺 DDR5 市场之际，根本无暇兼顾相对成熟的 DDR3 市场，因而开始逐步退出 DDR3 生产，以腾出设备及产能，全力冲刺单价与利润都更好的 DDR5 及 HBM 生产。

另外，中国台湾最大 DRAM 芯片制造商南亚科技目前产能主力也开始大幅转向 DDR4 及 DDR5，DDR3 仅开始接受客户代工订单。

（资料来源：芯智讯）

#### Q1 中国台湾半导体产值环比下滑 3% 预计 Q2 回升

中国台湾机构“工研院”统计显示，2024 年第一季度中国台湾半导体产业产值约 1.16 万亿元新台币（单位下同）环比下滑 3%，同比增长 15.7%；预计第二季度将环比回升 5.3%，达到 1.22 万亿元。

受到传统淡季效应影响，加上工作天数减少，中国台湾芯片制造、封装及测试产业第一季度产值环比滑落，其中 IC 制造业产值 7193 亿元，季减 4.3%；IC 封装业产值 987 亿元，季减 4.1%；IC 测试业产值 485 亿元，季减 0.6%。

一季度中国台湾 IC 设计业受惠于客户回补库存需求，产值达到 3002 亿元，季增 0.1%，是表现最佳的半导体次级产业。

机构表示，随着高性能计算（HPC）需求依然旺盛，大尺寸面板驱动 IC 需求升温，IC 制造业第二季度产值可望季增 7.6%，达 7743 亿元；IC 封装与测试业也将分别季增 7.7%、

9.5%，达到 1063 亿元、531 亿元。

展望 2024 年全年，机构预计中国台湾半导体产业产值将达到 5.1134 万亿元，年增长 17.7%，且半导体各领域均会实现正增长。其中 IC 设计业预计将达 1.2617 万亿元，增长 15.1%；IC 制造业预计将达 3.2014 万亿元，增长 20.2%；IC 封装业预计将达 4344 亿元；IC 测试业预计将达 2159 亿元。在 IC 制造行业中，预计晶圆代工产值将达到 2.9932 万亿元，增长 20.1%；存储芯片与其他制造为 2082 亿元，增长 22.4%。

（资料来源：集微网）

### 超 70 亿美元！为了芯片，韩国政府拼了

据韩国财政部 5 月 12 日声明，韩国财政部长崔相穆表示，韩国正在准备一项计划，提供超过 10 万亿韩元（约合 73 亿美元）以加强该国的关键半导体产业。

财政部在一份声明中称，该计划可能包括提供政策贷款、以及成立一个由国家和民间金融机构资助的新基金，例如通过政府、私营部门和韩国产业银行（KDB）政策融资的联合投资设立基金。财政部还表示，将积极与国会协商，延长定于今年年底结束的国家战略技术投资税收抵免，并考虑扩大国家战略技术研发和投资税收抵免的范围。

近年来，韩国一直在筹划一个所谓的“半导体巨型集群”，计划到 2047 年在首尔以南建立一个大型芯片集群。根据设想，该集群将成为世界上最大的此类高科技综合体，专注于尖端产品。具体来说，韩国政府计划在板桥建立无晶圆厂产业专属区，并在华城、龙仁、利川、平泽等地建立晶圆厂和存储芯片生产设施。

韩国还决定在安城建设材料、零部件、设备产业园区，在基兴和水原建设研发设施。根据该计划，该地区目前拥有 21 家制造工厂，到 2047 年将新增 16 家工厂，其中包括 3 家研究设施。

韩国产业通商资源部长官安德根表示：“早日完成半导体超级集群的建设，将在芯片领域获得世界领先的竞争力，并为年轻一代提供优质的就业机会。”

具体而言，三星电子计划投资 500 万亿韩元，其中包括：投资 360 万亿韩元在首尔以南 33 公里的龙仁新建 6 个晶圆厂；投资 120 万亿韩元在首尔以南 54 公里的平泽新建 3 个晶圆厂；投资 20 万亿韩元在器兴新建 3 个研究设施。

SK 海力士将投资 122 万亿韩元，在龙仁新建 4 个晶圆厂。韩国政府计划以民间投资为基础，以 2 纳米制程芯片和高带宽存储器等尖端产品为中心，打造世界级的生产能力。

韩国产业通商资源部还表示，这一规模达 622 万亿韩元的项目将创造 346 万个工作岗位。韩国政府预计，到 2030 年，韩国在全球非存储芯片市场的占有率将从目前的 3% 大幅上升到 10%。

随着大型产业集群的建设，韩国政府承诺通过将关键材料、零部件和设备供应链的自给率从目前的 30% 提高到 2030 年的 50% 来支持这一生态系统。

韩国总统尹锡悦强调，为寻求半导体超级集群的商机，外资企业接踵而至。得益于此，在各国外商投资纷纷腰斩的情况下，只有韩国去年在吸引外商直接投资方面创新高。

尹锡悦还表示，一座晶圆代工厂就需要一台 1.3 千兆瓦功率的核电机组，芯片产业需要高品质且稳定的电力供应，因此核电站必不可少。若走“脱核电”之路，不只是半导体，其他高新产业也得放弃。为了发展民生，应持续发展核电产业。

就今年即将到期的半导体投资减税政策，尹锡悦表示，政府将延长相关法律的有效期，今后会继续实施投资减税政策。该政策将进一步刺激半导体企业投资，增加相关生态链及全体企业的收益，同时创造就业岗位，增加国家税收。

近日有分析报告显示，随着美国通过芯片和科学法案大举引进半导体制造设施，约 10 年后的全球芯片供应链将以美国为中心进行重组。

美国 SIA 和 BCG 发布《半导体供应链新复苏弹性》报告认为，随着美国在原本被中国台湾和韩国两分天下的高端数字（非存储器）芯片领域扩大了占有率，据预计在 10nm 以下数字芯片领域美国的份额将从 2022 年的 0% 大幅增加到 2032 年的 28%，而韩国的占有率将从 2022 年的 31% 暴跌至 2032 年的 9%。虽然韩国在最尖端的逻辑芯片市场的地位下降，但因快速增长的 AI 芯片需求推动高带宽存储器（HBM）等 DRAM 市场井喷，韩国的 DRAM 产能将从 2022 年的 52% 进一步扩大到 2032 年的 57%。报告称：“韩国在芯片产业发展方面投资较早，为三星和 SK 海力士成长为全球芯片领导者提供了支持，在全球 NAND 闪存和 DRAM 市场分别占据了一半以上的份额。”

近几个月来，韩国芯片销售一直很活跃，使得整体出口出现反弹。数据显示，韩国今年 3 月出口同比增长 3.1%，为 565.6 亿美元，单月出口连续 6 个月保持增势。同期，进口为 522.8 亿美元，同比减少 12.3%。由此，3 月贸易收支实现 42.8 亿美元顺差。单月贸易收支自去年 6 月以来连续 10 个月保持顺差。

此外，根据韩国科技部的统计数据，2024 年 2 月韩国半导体出口额同比增长 62.9%，达到 99.6 亿美元。其中存储芯片出口额 60.8 亿美元，同比增 108.1%；逻辑芯片出口额 34.2 亿美元，同比增长 27.2%。

分析指出，这显示韩国整体工业生产的增长超预期，鉴于半导体在韩国出口中所占的份额最大，这一利好数据也预示了韩国国内经济增长的势头较好。

（资料来源：半导体产业纵横）

### 台积电扩产特殊工艺，为 HBM 4 做好准备

在 HBM4 内存带来的几个主要变化中，最直接的变化之一是内存接口的绝对宽度。随着第四代内存标准从已经很宽的 1024 位接口转向超宽的 2048 位接口，HBM4 内存堆栈将不再像往常一样工作；芯片制造商将需要采用比现在更先进的封装方法来容纳更宽的内存。

作为 2024 年欧洲技术研讨会演讲的一部分，台积电提供了有关将为 HBM4 制造的基础芯片的一些新细节，该芯片将使用逻辑工艺构建。由于台积电计划采用其 N12 和 N5 工艺的变体来完成这项任务，该公司预计在 HBM4 制造工艺中占据有利地位，因为内存工厂目前没有能力经济地生产如此先进的逻辑芯片——如果他们能够生产的话他们根本。

对于第一波 HBM4，台积电准备使用两种制造工艺：N12FFC+ 和 N5。虽然它们服务于相同的目的——将 HBM4E 内存与下一代 AI 和 HPC 处理器集成——但它们将以两种不同的方式用于连接 AI 和 HPC 应用程序的高性能处理器的内存。

台积电设计与技术平台高级总监表示：“我们正在与主要 HBM 内存合作伙伴（美光、三星、SK 海力士）合作，在先进节点上实现 HBM4 全堆栈集成。”“N12FFC+ 具有成本效益的基础芯片可以达到 HBM 的性能，而 N5 基础芯片可以在 HBM4 速度下以低得多的功耗提供更多逻辑。”

台积电采用 N12FFC+ 制造工艺（12nm FinFet Compact Plus，正式属于 12nm 级技术，但其根源于台积电经过充分验证的 16nm FinFET 生产节点）制造的基础芯片将用于在硅片上安装 HBM4 内存堆栈片上系统（SoC）旁边的中介层。台积电认为，他们的 12FFC+ 工艺非常适合实现 HBM4 性能，使内存供应商能够构建 12-Hi（48 GB）和 16-Hi 堆栈（64 GB），每堆栈带宽超过 2 TB/秒。

“我们还在针对 HBM4 优化 CoWoS-L 和 CoWoS-R，”台积电高级总监说道。“CoWoS-L 和 CoWoS-R 都[使用]超过八层，以实现 HBM4 的路由超过 2,000 个互连，并具有[适当

的]信号完整性。”

N12FFC+ 上的 HBM4 基础芯片将有助于使用 TSMC 的 CoWoS-L 或 CoWoS-R 先进封装技术构建系统级封装 (SiP)，该技术可提供高达 8 倍标线尺寸的中介层——足够的空间容纳多达 12 个 HBM4 内存堆栈。根据台积电的数据，目前 HBM4 可以在 14mA 电流下实现 6GT/s 的数据传输速率。

“我们与 Cadence、Synopsys 和 Ansys 等 EDA 合作伙伴合作，验证 HBM4 通道信号完整性、IR/EM 和热精度，”台积电代表解释道。

同时，作为一种更先进的替代方案，内存制造商还可以选择采用台积电的 N5 工艺来生产 HBM4 基础芯片。N5 构建的基础芯片将封装更多的逻辑，消耗更少的功耗，并提供更高的性能。但可以说，最重要的好处是，这种先进的工艺技术将实现非常小的互连间距，约为 6 至 9 微米。这将允许 N5 基础芯片与直接键合结合使用，从而使 HBM4 能够在逻辑芯片顶部进行 3D 堆叠。直接键合可以实现更高的内存性能，这对于总是寻求更多内存带宽的 AI 和 HPC 芯片来说预计将是一个巨大的提升。

我们已经知道台积电和 SK 海力士在 HBM4 基础芯片上进行合作。台积电也可能为美光生产 HBM4 基础芯片。否则，我们会更惊讶地看到台积电与三星合作，因为该集团已经通过其三星代工部门拥有自己的先进逻辑工厂。

随着德国和日本的新工厂全部建成，以及中国产能的扩张，台积电计划到 2027 年将其特种技术产能扩大 50%。该公司在欧洲技术研讨会上透露本周，台积电预计不仅需要转换现有产能以满足特殊工艺的需求，甚至还需要为此目的建造新的（绿地）晶圆厂空间。这一需求的主要驱动力之一将是台积电的下一个专用节点：N4e，一个 4 纳米级超低功耗生产节点。

“过去，我们总是对即将建成的晶圆厂进行审查阶段，但在台积电很长一段时间以来，我们第一次开始建设绿地晶圆厂，以满足未来的专业技术要求，”台积电业务发展和海外运营办公室高级副总裁 Kevin Zhang 博士出席活动时说。“在未来四到五年内，我们的专业产能实际上将增长 1.5 倍。通过这样做，我们实际上扩大了制造网络的覆盖范围，以提高整个晶圆厂供应链的弹性。”

除了 N5 和 N3E 等著名的主要逻辑节点之外，台积电还为功率半导体、混合模拟 I/O 和超低功耗应用（例如物联网）等应用提供一套专用节点。这些通常基于该公司的落后制造工艺，但无论底层技术如何，这些节点的容量需求都随着台积电主要逻辑节点的需求而增长。所有这些都要求台积电重新评估他们如何规划其专业节点的容量。

台积电近年来的扩张战略追求几个目标。其中之一是在台湾以外建立新的晶圆厂；另一个是普遍扩大产能，以满足未来对所有类型工艺技术的需求——这就是该公司正在建设专业节点产能的原因。

目前，台积电最先进的专用节点是 N6e，是 N7/N6 的变体，支持 0.4V 至 0.9V 之间的工作电压。对于 N4e，台积电正在考虑低于 0.4V 的电压。尽管目前台积电并未透露太多计划节点的技术细节；考虑到该公司在这里的历史，我们预计一旦新流程准备就绪，他们明年将有更多话题可以讨论。

（资料来源：半导体行业观察）

## 5.2、消费电子

### 到 2028 年苹果将有 25% 的 iPhone 在印度生产

印度电子和 IT 国务部长 Rajeev Chandrasekhar 表示，到 2028 年，预计苹果公司将有 25% 的 iPhone 在印度生产。Rajeev Chandrasekhar 赞扬了印度总理莫迪的生产挂钩激励 (PLI) 计划，并补充道：“苹果正在通过建立本地供应商网络来深化生态系统。”

当地媒体报道的一份报告称，苹果已经开始建立印度本地供应链。尽管其大部分生产将由富士康和塔塔电子承担，但富士康和塔塔电子也将扩大其在印度的制造能力。富士康是全球最大的代工制造商，也是苹果公司最大的代工制造商，在印度制造的 iPhone 中占据了最大份额。

去年 10 月，塔塔电子以 1.25 亿美元收购了 iPhone 制造商纬创在印度的制造子公司。塔塔电子目前生产的 iPhone 数量要少得多，但打算扩大其生产能力。塔塔电子还在讨论收购另一家 iPhone 制造商和硕在印度的业务。

2023 年 1 月之前，印度仅负责苹果制造的 5% 至 7%，但到 2023 年底，印度生产的 iPhone 产量达到了 14%。印度目前已生产的 iPhone 型号有 iPhone 12、13、14 和 15。

一位相关人士表示，苹果计划到 2027 年底或 2028 年将这一水平提高到 24-25%。

摩根大通分析师曾在 2022 年预计，到 2025 年，四分之一的苹果产品将在中国以外制造，而当时的比例仅为 5%。

(资料来源：集微网)

### Q1 全球平板电脑出货量年减 3%，联想/小米上榜

研究机构 TechInsights 最新报告显示，在安卓平板电脑厂商和中国本土品牌的强劲业绩带动下，全球平板电脑市场出货量在 2024 年 Q1 仅同比下降 3%。苹果凭借 iPad 系列依旧牢牢占据首位，中国品牌联想、小米实现强劲增长，上榜前五位。

分品牌看，第一季度苹果出货量达 1140 万台，份额 35%，同比减少 11%；三星位居第二，出货量 670 万台，份额 21%；联想出货量 230 万台位居第三，同比增长 20%，份额 7%；亚马逊排名第四，出货量 220 万台，同比下滑 18%；小米排名第五，得益于新推出的小米平板 6 系列强劲表现，出货量 200 万台大增 117%，份额 6%。

机构表示，在三星、联想、小米的带动下，安卓平板电脑市场份额达到 52%，出货量同比增长 2% 至 1690 万部，为两年来的最高水平。虽然苹果的增长轨迹正朝着正确的方向发展，但苹果缺乏创新产品正在损害其用户基础的需求，并促使新客户转向改进高端产品组合的安卓供应商。

(资料来源：集微网)

### Q1 全球真无线耳机出货量达 6500 万，小米大增 61% 升至第二

研究机构 Canalisys 报告显示，2024 年第一季度全球真无线耳机 (TWS) 市场稳健增长，出货量达到 6500 万，同比增长 6%。苹果以 25% 的份额依旧稳居第一，出货量达到 1600 万，但同比小幅下滑 8%；小米凭借出色的表现同比大增 61%，出货量达 550 万，超越三星升至第二名，市场份额 8%。

机构表示，虽然三星的增长速度相对较平缓，但其全球市场影响力依然不容小觑。第



一季度三星 TWS 耳机出货量 520 万，市场份额 8% 位居第三；印度厂商 boAt 位居第四，实现 7% 同比增长，市场份额 5%；华为则通过加大投入入门级产品的战略部署，以及开放式耳机的推出，位居第五，市场份额 3%。

Canalys 认为，印度市场对于 TWS 产品的需求仍在增加，boAt 有望在未来进一步扩大市场份额；华为在 TWS 市场的竞争力正在逐步提升，未来有望进一步挑战其他厂商的市场地位。

中国 TWS 市场方面，小米以 20% 的份额位居榜首；苹果份额 12% 位居第二；华为份额 12% 位居第三；漫步者份额 11% 排名第四；倍思位居第五，份额达到 9%。

美国 TWS 市场中，苹果以 50% 的份额高居榜首；中东市场（CEE）中，小米超越苹果位居第一，市场份额达到 18%。

（资料来源：集微网）

### 5.3、汽车电子

#### 美拜登政府大幅加征对华关税 商务部：中方坚决反对并严正交涉

5月14日，商务部新闻发言人就美方发布对华加征301关税四年期复审结果发表谈话。

谈话指出，5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。中方坚决反对并严正交涉。

美方出于国内政治考虑，滥用301关税复审程序，进一步提高部分对华产品加征的301关税，将经贸问题政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方对此表示强烈不满。世贸组织早已裁决301关税违反世贸组织规则。美方非但不予以纠正，反而一意孤行，一错再错。

美方提高301关税违背了拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合两国元首达成的共识精神，这将严重影响双边合作氛围。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。中方将采取坚决措施，捍卫自身权益。

日前有消息称，美国拜登总统指示贸易代表根据1974年贸易法第301条对来自中国的180亿美元进口商品提高关税，以保护美国工人和企业。其中，半导体关税将在2025年从25%提高到50%；2024年，钢铁和铝产品的关税税率将从0~7.5%提高到25%，电动汽车关税税率将从25%提高到100%，电动汽车锂离子电池关税税率将从7.5%提高到25%，太阳能电池（无论是否组装成组件）的关税将从25%提高到50%。此外美国还将提升船岸起重机及医疗产品的对华关税。

（资料来源：集微网）

#### 丰田、日产和本田将合作开发下一代汽车的AI和芯片

丰田汽车、日产汽车、本田汽车和其他主要日本汽车制造商将合作开发下一代汽车的软件，汇集他们在生成式人工智能（AI）和半导体等领域的专业知识。

在即将宣布的汽车行业数字化转型战略中，日本经济产业省将呼吁汽车制造商之间的合作，作为2030年代下一代汽车发展的路线图。汽车制造商将签署启动合作的战略，希望在竞争激烈的数字化竞赛中降低开发成本。该战略重点在于软件定义汽车（SDV），这是一种通过软件而不是硬件（如发动机和零件）改进车辆功能的概念。例如，没有自动驾驶技术的车辆可以通过软件更新获得该功能。一些技术问题也可以通过更新来解决，类似于智能手机。

特斯拉和比亚迪的一些已经上市的电动汽车已经具备这些能力。随着半导体技术和人工智能的发展，汽车制造商对软件趋势的响应将对其全球竞争力产生重大影响。丰田、日产等计划从2025年开始推出SDV。政府鼓励日本汽车制造商在七个领域合作，以支持开发和市场扩张。

这七个领域是芯片、连接车辆软件和系统的应用程序编程接口、虚拟仿真、可以自动检查的生成式人工智能、针对网络攻击的安全措施、自动驾驶的高精度3D地图，以及测量车辆与物体或行人之间距离的技术。如果不同制造商有不同的规格，成本和开发时间可能会增加。该部门呼吁在七个领域实现标准化，制造商不太可能开发独特的专有技术。

车辆中使用的基本操作系统将由各公司独立开发。如果SDV技术更加普及，汽车制造商将从后续的软件更新中产生收入，而不仅仅是汽车销售。如果日本在汽车软件开发方面落后，相关的零部件和材料行业可能会受到严重打击。

(资料来源: 集微网)

### 我国 4 月新能源汽车产销量同比增长均超 30%

工信部公布数据显示, 2024 年 4 月我国汽车产销分别完成 240.6 万辆和 235.9 万辆, 其中新能源汽车产销分别完成 87 万辆和 85 万辆, 同比分别增长 35.9% 和 33.5%, 呈现较快增长态势。

4 月我国乘用车产销分别完成 204.8 万辆和 200.1 万辆, 商用车产销分别完成 35.8 万辆和 35.7 万辆, 均实现同比增长。4 月, 新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 36%。

1—4 月数据方面, 我国新能源汽车产销分别完成 298.5 万辆和 294 万辆, 同比分别增长 30.3% 和 32.3%, 新车销量占比为 32.4%。

出口方面, 4 月我国汽车整车出口 50.4 万辆, 同比增长 34%。新能源汽车出口 11.4 万辆, 同比增长 13.3%。

(资料来源: 集微网)

### 传比亚迪进军越南受阻, 最大合作方终止合作

据电车出海 5 月 13 日消息, 比亚迪越南合作经销商 New Energy Holdings (NEH) 突然中止与比亚迪的一切合作, 这一让人吃惊的决定给比亚迪在越南的扩张速度留下了疑问。

据报道, NEH 正是比亚迪越南计划的最大合作伙伴之一。NEH 此前曾表示将在未来 6 个月内至少开设 9 家比亚迪展厅, 分布在首都河内和最大城市和商业中心胡志明市。此外, NEH 的计划似乎已处于后期阶段, 该公司早在 4 月底就在积极招募员工。

比亚迪几天前发布越南路线图, 目标是到今年年底, 在越南开设 50 家经销商店, 今年下半年在越南销售 5000 辆汽车。首批 15 家将于 6 月开业, 初期将推出 3 款车型, 包括 ATTO 3、海豚和海豹, 预计下半年将推出汉和唐等车型。

虽然比亚迪官方表示, 在越南的计划不会受到 NEH 退出的影响, 他们在越南还有很多合作伙伴。然而, NEH 约占计划经销商的五分之一, 这似乎可能给比亚迪布局越南市场蒙上一层阴影。

另传 NEH 退出的原因是由于业务战略的调整而做出的, 该计划将过于分散资源, 难以实现目标。

(资料来源: 集微网)

## 6、行业重点公司公告

图表 41：本周重点公司公告

公告日期	证券代码	公告标题	主要内容
2024-05-12	688332.SH	<a href="#">中科蓝讯:2023 年年度权益分派实施公告</a>	中科蓝讯公司 2023 年年度权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本 120,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.83 元（含税），共计派发现金红利 99,600,000 元。
2024-05-13	688262.SH	<a href="#">国芯科技:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告</a>	截至 2024 年 5 月 13 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 467,839 股，占公司总股本的 0.139238%，回购成交的最高价为 20.14 元/股，最低价为 20.00 元/股，支付的资金总额为人民币 9,393,742.78 元。
2024-05-14	872190.BJ	<a href="#">雷神科技:2023 年年度权益分派实施公告</a>	雷神科技公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,001 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，本次权益分派共计派发现金红利 10,000,000.10 元。
2024-05-14	688010.SH	<a href="#">福光股份:关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告</a>	截至 2024 年 5 月 14 日，福光股份公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 1,723,682 股，占公司总股本 160,561,578 股的比例为 1.0735%，回购成交的最高价为 19.00 元/股，最低价为 15.47 元/股，支付的资金总额为人民币 3,002.61 万元。
2024-05-14	300806.SZ	<a href="#">斯迪克:2023 年年度权益分派实施公告</a>	斯迪克公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,221,971 股后的 451,078,532 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金。
2024-05-15	688106.SH	<a href="#">金宏气体:关于 2023 年年度利润分配方案调整总股本及对应分配总额的公告</a>	金宏气体公司 2023 年年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本 487,569,513 股，扣除公司回购专户上已回购股份 7,081,000 股后的 480,488,513 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元。
2024-05-16	688486.SH	<a href="#">龙迅股份关于调整 2023 年度利润分配现金红利每股分配比例及资本公积转增股本总额的公告</a>	龙迅股份公司 2023 年度利润分配方案调整为：以公司总股本 69,264,862 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 356,697 股后的 68,908,165 股为基数，向全体股东每股派发现金红利为 1.40255 元。
2024-05-16	688608.SH	<a href="#">恒玄科技:关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告</a>	恒玄科技公司 2023 年度利润分配方案调整为：以公司总股本为 120,034,708 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 860,708 股后的 119,174,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元。
2024-05-17	688025.SH	<a href="#">杰普特:关于调整 2023 年度利润分配方案每股分红金额的公告</a>	杰普特公司 2023 年度利润分配方案调整为：以公司总股本 95,049,423 股为基数，扣减回购专用账户的股数 437,970 股后的 94,611,453 股为基数，每股派发现金红利 0.35057 元
2024-05-17	300567.SZ	<a href="#">精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告</a>	武汉精测电子公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,685,315 股后 273,466,333 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。

资料来源：Wind，华鑫证券研究

### 中科蓝讯:2023 年年度权益分派实施公告

本次利润分配方案经本公司 2024 年 4 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

发放年度为 2023 年年度，分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 120,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.83 元（含税），共计派发现金红利 99,600,000 元。

### 国芯科技:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

#### 一、 回购股份的基本情况

2024年4月18日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币32.56元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含);回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

#### 二、 回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下:

2024年5月13日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份467,839股,占公司总股本的0.139238%,回购成交的最高价为20.14元/股,最低价为20.00元/股,支付的资金总额为人民币9,393,742.78元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

### 雷神科技:2023年年度权益分派实施公告

本公司2023年年度权益分派方案已获2024年4月26日召开的股东大会审议通过,本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为299,256,040.93元,母公司未分配利润为144,462,540.28元。本次权益分派共计派发现金红利10,000,000.10元。

本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本100,000,001股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金。

本次分派对象为:截止2024年5月22日下午北京证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。投资者R日(R日为权益登记日)买入的证券,享有相关权益;对于投资者R日卖出的证券,不享有相关权益。

### 福光股份:关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

2024年2月19日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益,回购价格不超过30.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。

截至2024年5月14日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为1,723,682股,占公司总股本160,561,578股的比例为1.0735%,回购成交的最高价为19.00元/股,最低价为15.47元/股,支付的资金总额为3,002.61万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

### 斯迪克:2023 年年度权益分派实施公告

本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,221,971 股后的 451,078,532 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

本次权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。截至 2024 年 5 月 14 日，公司总股本为 453,300,503 股，回购专用证券账户中的公司股份数为 2,221,971 股，为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股权登记日期间公司总股本、回购股份数将不发生变化，因此公司实际参与分配的股本为公司现有总股本 453,300,503 股剔除已回购股份 2,221,971 股后的 451,078,532 股，公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=451,078,532 股×0.02 元/股=9,021,570.64 元。

本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。

### 金宏气体:关于 2023 年年度利润分配方案调整总股本及对应分配总额的公告

本次调整原因：自公司 2023 年年度利润分配方案披露之日起至 2024 年 5 月 15 日，公司发生限制性股票归属登记及可转换公司债券转股事项，致使可参与分派的股份数量发生变动。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至 2024 年 5 月 14 日，公司总股本已由 2023 年年度利润分配方案披露之日 2024 年 3 月 26 日的 486,943,322 股增加为 487,569,513 股。

依据上述总股本变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，对 2023 年度利润分配方案的总股本及对应的分配总额进行调整，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，即调整后总股本=实施权益分派股权登记日登记的总股本-公司回购专用证券账户中股份=487,569,513-7,081,000=480,488,513 股，调整后利润分配总额=每股现金红利×调整后总股本=0.35×480,488,513=168,170,979.55 元（含税）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司 2023 年度利润分配方案调整为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），利润分配总额为 168,170,979.55 元（含税），占公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润的 53.39%。

### 龙迅股份关于调整 2023 年度利润分配现金红利每股分配比例及资本公积转增股本总额的公告

本次调整原因：自 2023 年度利润分配预案披露之日起至 2024 年 5 月 16 日，本公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变的原则，相应调整每股分配比例和转增总额。

截至 2024 年 5 月 16 日，公司总股本为 69,264,862 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 482,095 股，本次实际参与分配的股本数为 68,782,767 股。

根据上述公司回购专用证券账户中股份数变动情况，公司按照分配总额和每股转增比

例不变的原则，对 2023 年年度利润分配每股派发现金红利金额及资本公积金转增股本总额进行相应调整，变动情况如下：

1、确定每股派发现金红利为 1.40255 元（含税），即调整后：

每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数=96,471,431.00÷68,782,767≈1.40255 元（含税，保留五位小数）。

公司本次实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股本总数=68,782,767×1.40255=96,471,269.86 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

本年度公司现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 93.94%。

2、确定本次转增股本总额为 33,015,728 股，即调整后：

调整后转增股本总额=每股转增比例×最终参与分配的公司股本总=0.48×68,782,767=33,015,728 股。

本次转增后公司总股本=实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本+调整后转增股本总额=69,264,862+33,015,728=102,280,590 股。

综上所述，公司 2023 年度利润分配调整为：每股派发现金红利 1.40255 元（含税），利润分配总额为 96,471,269.86 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）；本次转增股本总额为 33,015,728 股，转增后公司总股本为 102,280,590 股（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），具体以权益分派实施结果为准。

#### 恒玄科技:关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告

本次调整原因：自公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至 2024 年 5 月 16 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份 23,972 股，公司回购专用证券账户股数增加至 860,708 股，按照维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

截至 2024 年 5 月 16 日，公司总股本为 120,034,708 股，以总股本为基准，扣减回购专用证券账户中股份总数 860,708 股，公司拟参与利润分配的股本总数为 119,174,000 股。按照每股分配比例不变的原则，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），合计拟派发现金红利元 19,067,840.00 元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

#### 杰普特:关于调整 2023 年度利润分配方案每股分红金额的公告

##### 一、本次调整的原因

2024 年 5 月 15 日，公司披露了《深圳市杰普特光电股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-033），公司新增股份 58,478 股。2024 年 5 月 10 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由 94,990,945 股增加至 95,049,423 股。

自 2023 年度利润分配方案披露之日起至 2024 年 5 月 17 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，回购专用证券账户中股份数由 224,864 股增加至 437,970 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股

份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。因此，扣除公司回购专用证券账户的股份 437,970 股后，公司本次实际参与分配的公司股本总数调整为 94,611,453 股。

依据上述实际参与分配的公司股本总数变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，对 2023 年度利润分配预案的每股分配比例进行相应调整，确定每股派发现金红利为 0.35057 元（含税），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实际参与分配的公司股本总数=33,168,128.35÷94,611,453≈0.35057 元（含税，保留小数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股本总数=0.35057×94,611,453=33,167,937.08 元（含税，保留小数点后两位）。

## 二、调整后的利润分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 95,049,423 股为基数，扣减回购专用账户的股数 437,970 股，每股派发现金红利 0.35057 元（含税，保留小数点后五位），共计派发现金红利 33,167,937.08 元（含税，保留小数点后两位，本次利润分配总额差异是每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

### 精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,685,315 股后 273,466,333 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年度利润分配，故公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 54,693,266.60 元=（278,151,648-4,685,315）股×0.2 元/股。按总股本 278,151,648 股折算每 10 股现金分红的比例=本次实际现金分红总额/公司总股本\*10=54,693,266.60 元/278,151,648 股\*10=1.966311 元/股。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1966311 元/股。

本次权益分派实施后，公司可转债“精测转债”转股价格将由 48.79 元/股调整为 48.59 元/股，公司可转债“精测转 2”转股价格将由 64.54 元/股调整为 64.34 元/股。

## 7、风险提示

- (1) 半导体制裁加码
- (2) 晶圆厂扩产不及预期
- (3) 研发进展不及预期
- (4) 地缘政治不稳定
- (5) 推荐公司业绩不及预期



## ■ 电子通信组介绍

**毛正：**复旦大学材料学硕士，三年美国半导体上市公司工作经验，曾参与全球领先半导体厂商先进制程项目，五年商品证券投研经验，2018-2020 年就职于国元证券研究所担任电子行业分析师，内核组科技行业专家；2020-2021 年就职于新时代证券研究所担任电子行业首席分析师，iFind 2020 行业最具人气分析师，东方财富 2021 最佳分析师第二名；东方财富 2022 最佳新锐分析师；2021 年加入华鑫证券研究所担任电子行业首席分析师。

**高永豪：**复旦大学物理学博士，曾先后就职于华为技术有限公司，东方财富证券研究所，2023 年加入华鑫证券研究所。

**吕卓阳：**澳大利亚国立大学硕士，曾就职于方正证券，4 年投研经验。2023 年加入华鑫证券研究所，专注于半导体材料、半导体显示、碳化硅、汽车电子等领域研究。

**何鹏程：**悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所通信组，2023 年加入华鑫证券研究所。专注于消费电子、算力硬件等领域研究。

**张璐：**早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023 年加入华鑫证券研究所，研究方向为功率半导体、先进封装。

## ■ 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## ■ 证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	> 20%
2	增持	10% — 20%
3	中性	-10% — 10%
4	卖出	< -10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	> 10%
2	中性	-10% — 10%
3	回避	< -10%

以报告日后的 12 个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

**相关证券市场代表性指数说明：**A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。

## ■ 免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。